

**ELMOS Semiconductor AG**

**Dortmund**

**Jahresabschluss und Lagebericht**

**31. Dezember 2009**

## Bestätigungsvermerk

Zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht haben wir folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Dortmund, 3. März 2010

Ernst & Young GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Krebs  
Wirtschaftsprüfer

Fürst  
Wirtschaftsprüfer



**ELMOS Semiconductor AG, Dortmund**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für 2009**

	EUR	EUR	2008 TEUR
1. Umsatzerlöse	108.917.186,52		159.439
2. Erhöhung oder Verminderung (-) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-4.604.592,81		3.489
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	159.120,63		184
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>4.779.475,51</u>		<u>4.977</u>
		109.251.189,85	----- 168.089
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-11.910.994,87		-20.101
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-29.288.638,08		-49.399
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-27.492.417,31		-33.198
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung EUR 145.421,20 (Vj. TEUR 136)	-5.088.401,82		-5.828
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-10.993.133,26		-13.848
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-43.783.365,02</u>		<u>-50.739</u>
		-128.556.950,36	----- -173.113
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen EUR 28.516.119,32 (Vj. TEUR 1.848)	28.516.119,32		1.848
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen EUR 1.105.000,00 (Vj. TEUR 1.364)	1.105.000,00		1.364
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vj. TEUR 4.154)	921.753,69		5.623
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-25.787,32		0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 2.660.864,69 (Vj. TEUR 2.349)	-4.951.147,19		-5.039
		<u>25.565.938,50</u>	----- <u>3.796</u>
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		6.260.177,99	----- -1.228
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	47.833,23		-1.355
16. Sonstige Steuern	<u>-305.846,09</u>		<u>-325</u>
		-258.012,86	----- -1.680
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)		6.002.165,13	-2.908
18. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		<u>36.713.349,40</u>	<u>39.621</u>
19. Bilanzgewinn		<u>42.715.514,53</u>	<u>36.713</u>

# ELMOS Semiconductor AG, Dortmund

## Anhang für 2009

---

### Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des AktG und der Satzung aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

### Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene **immaterielle Vermögensgegenstände** sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen (3 - 10 Jahre, lineare Methode) vermindert.

Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die **Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens** werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze abgeschrieben. Soweit steuerlich zulässig, wird für bewegliche Anlagegüter die degressive Abschreibungsmethode angewandt. Zur linearen Methode wird in dem Jahr, für welches die lineare Methode erstmals zu höheren Jahresabschreibungsbeträgen führt, übergegangen. Die übrigen Anlagegüter werden linear abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 150,00 (bis zum 31. Dezember 2007 EUR 410,00), sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt. Für Anlagegüter mit einem Netto-Einzelwert von mehr als EUR 150,00 bis EUR 1.000,00, die nach dem 31. Dezember 2007 angeschafft worden sind, wurde der jährlich steuerlich zu bildende Sammelposten aus Vereinfachungsgründen in die Handelsbilanz übernommen. Von den jährlichen Sammelposten, deren Höhe insgesamt von untergeordneter Bedeutung ist, werden entsprechend den steuerlichen Vorschriften pauschalierend jeweils 20 % p.a. im Jahr, für dessen Zugänge er gebildet wurde, und den vier darauf folgenden Jahren abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen.

Bei den **Finanzanlagen** werden die Anteilsrechte und Wertpapiere zu Anschaffungskosten bzw. niedrigeren beizulegenden Werten und die Ausleihungen grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Ansprüche aus Rückdeckungsversicherung werden zum Aktivwert angesetzt.

Die **Vorräte** werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren Tageswerten angesetzt. Die Bestände an **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen** sind zu durchschnittlichen Einstandspreisen oder zu niedrigeren Tagespreisen am Bilanzstichtag aktiviert.

Für ein Freihand- sowie ein Ersatzteillager wurden **Festwerte** gebildet.

Die **unfertigen und fertigen Erzeugnisse** sind auf der Basis von Einzelkalkulationen, die auf der aktuellen Betriebsabrechnung beruhen, zu Herstellungskosten bewertet, wobei neben den direkt zurechenbaren Materialeinzelkosten, Fertigungslöhnen und Sondereinzelkosten auch Fertigungs- und Materialgemeinkosten sowie Abschreibungen entsprechend dem steuerrechtlichen Mindestumfang berücksichtigt werden. In allen Fällen wurde verlustfrei bewertet, d. h. es wurden von den voraussichtlichen Verkaufspreisen Abschläge für noch anfallende Kosten vorgenommen.

Alle erkennbaren Risiken im **Vorratsvermögen**, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Die **Rückstellungen für Pensionen und Vorruhestandsverpflichtungen** werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt. Den Teilwerten gemäß § 6a EStG liegt ein Rechnungszinsfuß von 6 % zugrunde.

Die **Steuerrückstellungen** und die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

**Verbindlichkeiten** sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Zuschüsse auf Entwicklungsleistungen werden als erhaltene Anzahlungen ausgewiesen.

**Fremdwährungen** wurden zu Umrechnungskursen am Tage ihrer Entstehung oder zu niedrigeren bzw. höheren Stichtagskursen bilanziert.

## **Erläuterungen zur Bilanz**

### **Anlagevermögen**

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

## Angaben zum Anteilsbesitz

	Währung	Beteiligungen %	Eigenkapital in Tausend	Ergebnis in Tausend
<b>Inland</b>				
Advanced Appliances Chips GmbH, Riedstadt	EUR	33,33	190	-51 <sup>1</sup>
attoSENSOR GmbH, Penzberg	EUR	45,00	63	2 <sup>1</sup>
DMOS Dresden MOS Design GmbH, Dresden	EUR	20,00	230	-53 <sup>1</sup>
ELMOS Central IT Services GmbH & Co. KG, Dortmund	EUR	100,00	173	122 <sup>2</sup>
ELMOS Facility Management GmbH & Co. KG, Dortmund	EUR	100,00	92	57 <sup>2</sup>
ELMOS Industries GmbH, Hanau	EUR	49,00	-1.094	-67
ELMOS Semiconductor Süd GmbH, München	EUR	100,00	176	0 <sup>2</sup>
Epigone Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG, Mainz	EUR	6,00	-6	-9 <sup>1</sup>
GED Gärtner Electronic Design GmbH, Frankfurt/Oder	EUR	73,90	1.472	212
Gesellschaft für Halbleiterprüftechnik mbH, Dortmund	EUR	100,00	124	6 <sup>3</sup>
IndustrieAlpine Bauträger GmbH, München	EUR	51,00	-1.079	-82 <sup>1</sup>
Mechaless Systems GmbH, Karlsruhe	EUR	100,00	430	-74
<b>Ausland</b>				
ELMOS Services B.V., Nijmegen (NL)	EUR	100,00	4.708	4.692
Elmos Advanced Packaging B.V., Nijmegen (NL)	EUR	100,00	-1.249	-2.233 <sup>2</sup>
ELMOS Design Services B.V., Nijmegen (NL)	EUR	100,00	3.971	2.613 <sup>2</sup>
ELMOS Quality Services B.V., Nijmegen (NL)	EUR	100,00	210	5 <sup>2</sup>
European Semiconductor Assembly (Eurasem) B.V., Nijmegen (NL)	EUR	100,00	18	0 <sup>2</sup>
Micro Systems on Silicon (MOS) Limited, Pretoria (Südafrika)	ZAR	67,60	-168	-7 <sup>2</sup>
ELMOS France S.A.S., Levallois Perret (F)	EUR	100,00	1.699	502
ELMOS USA Inc., Farmington Hills (USA)	USD	100,00	--	-- <sup>4</sup>
ELMOS N.A. Inc., Farmington Hills (USA)	USD	100,00	567	48 <sup>2</sup>
Silicon Microstructures Inc., Milpitas (USA)	USD	100,00	-3.266	-2.025 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Die vorgelegten Zahlen beruhen auf vorläufigen, ungeprüften Abschlüssen zum 31. Dezember 2009.

<sup>2</sup> Es handelt sich um mittelbaren Anteilsbesitz der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund.

<sup>3</sup> Die vorgelegten Zahlen beruhen auf dem Abschluss zum 31. Dezember 2008.

<sup>4</sup> Es liegt bislang kein Jahresabschluss der Gesellschaft vor.

## **Vorräte**

Im Geschäftsjahr wurden außerplanmäßige Abschreibungen auf Vorratsvermögen in Höhe von TEUR 400 vorgenommen.

## **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben bis auf einen Betrag von TEUR 68 (Vj. TEUR 98) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind aktivierte Forderungen auf Erstattung von verauslagten Entwicklungskosten in Höhe von TEUR 114 (Vj. TEUR 480) enthalten.

## **Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten**

Hierin ist ein Disagio in Höhe von TEUR 55 enthalten.

## **Eigenkapital**

Das in der Bilanz zum 31. Dezember 2009 aus 19.414.205 auf den Inhaber lautenden, nennwertlosen Stückaktien bestehende Grundkapital in Höhe von EUR 19.414.205,00 ist voll eingezahlt.

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 18. Mai 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu EUR 9.650.000,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 9.650.000 Stück neuer, auf den Inhaber lautender Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen und gem. § 204 AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Ausgabe zu entscheiden (Genehmigtes Kapital I).

Das Grundkapital ist um bis zu EUR 264.672,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 1999). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Führungsorgane und an Mitarbeiter verbundener Unternehmen (Aktienoptionsprogramm 1999).

Das Grundkapital ist um bis zu EUR 145.244,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Bezugs-

rechten an Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Führungsorgane und an Mitarbeiter verbundener Unternehmen (Aktienoptionsplan 2004).

Das Grundkapital ist um bis zu EUR 3.900.000,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Wandel- oder Optionsanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. einer Kombination dieser Instrumente), die von der ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft oder einer Konzerngesellschaft der ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft im Sinne von § 18 AktG aufgrund der von der Hauptversammlung vom 6. Mai 2009 unter Tagesordnungspunkt 7 b) beschlossenen Ermächtigung I bis zum 5. Mai 2014 ausgegeben werden, von ihren Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur Wandlung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung erfüllen, soweit nicht ein Barausgleich gewährt wird oder eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt werden.

Das Grundkapital ist um weitere bis zu EUR 3.900.000,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/II). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Wandel- oder Optionsanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. einer Kombination dieser Instrumente), die von der ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft oder einer Konzerngesellschaft der ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft im Sinne von § 18 AktG aufgrund der von der Hauptversammlung vom 6. Mai 2009 unter Tagesordnungspunkt 7 c) beschlossenen Ermächtigung II bis zum 5. Mai 2014 ausgegeben werden, von ihren Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur Wandlung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung erfüllen soweit nicht ein Barausgleich gewährt wird oder eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt werden.

Das Grundkapital ist um bis zu EUR 1.000.000,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/III). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Einlösung von Bezugsrechten, die auf der Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 6. Mai 2009 bis zum 5. Mai 2014 an Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Geschäftsführung und Mitarbeiter verbundener Unternehmen gewährt werden (Aktienoptionsplan 2009).

Es bestehen Bezugsrechte gemäß § 192 Abs. 2 Nr. 3 AktG aus einem Aktienoptionsprogramm für Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter zum Erwerb von 627.106 Aktien. Jedes Bezugsrecht berechtigt zum Bezug einer Stückaktie ohne Nennwert mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00.

### **Gratisaktienprogramm (Stock Awards)**

In den Jahren 2007 und 2008 wurden Gratisaktien-Programme (Stock Awards) aufgelegt. Die Stock Awards wurden an besonders verdiente Mitarbeiter, Führungskräfte und Mitglieder des Vorstandes in Anerkennung für die im Vorjahr erbrachte Leistung vergeben. Die Programme umfassten 29.000 Aktien in 2007 und 50.000 Aktien in 2008, welche zuvor an der Börse zurückgekauft wurden. Für die Stock Awards gilt eine Haltefrist von zwei Jahren; davon ausgenommen ist ein Verkauf von Aktien in der erforderlichen Anzahl, so dass die Steuern, die auf den geldwerten Vorteil entstehen, beglichen werden können. In 2009 wurde kein Stock Award Programm vergeben.

## **Bilanzgewinn**

Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag von EUR 36.713.349,40 enthalten; im Übrigen verweisen wir auf den unten stehenden Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns.

## **Rückstellungen**

Die Pensionsrückstellungen wurden für ehemalige Mitglieder des Vorstands bzw. deren Hinterbliebene gebildet.

Die Steuerrückstellungen betreffen betriebliche Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für nachkommende Rechnungen, Lizenzen, Tantiemen, Garantieleistungen, Berufsgenossenschaftsbeiträge, sonstige Personalrückstellungen und Altersteilzeitansprüche gebildet.

## **Verbindlichkeiten**

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind im nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel im Einzelnen dargestellt.

Die Verbindlichkeiten enthalten keine gegenüber Gesellschaftern.

## Verbindlichkeitspiegel in TEUR

Art der Verbindlichkeit	gesamt 31.12.2009	Restlaufzeit			gesamt 31.12.2008
		unter 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	40.380	380	40.000	0	40.000
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	394	394	0	0	30
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.438	4.438	0	0	8.039
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	19.582	19.582	0	0	56.551
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	404	404	0	0	436
6. Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	797 (889)	654	107	36	889
- davon aus Steuern (Vorjahr)	562 (677)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (Vorjahr)	0 (0)				

### Angabe von Art und Form der Sicherheiten

Die Darlehen und das Schuldscheindarlehen wie auch die Betriebsmittellinien sind unbesichert vergeben. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bis auf branchenüblich verlängerte Eigentumsvorbehalte von Lieferanten, sind im Wesentlichen nicht besichert. Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ebenfalls nicht besichert.

### Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

#### Haftungsverhältnisse

Für ein verbundenes Unternehmen besteht unverändert zum Vorjahr eine Bürgschaft in Höhe von TEUR 11.

Im Rahmen einer Leasingstruktur hat sich ELMOS gesamtschuldnerisch nachrangig mitverpflichtet, Miet- und Mieterdarlehenszahlungen zu leisten. Zum Stichtag 31. Dezember 2009 betragen die kumulierten Restmietzahlungen bis zum Laufzeitende im Jahr 2017 TEUR 2.546 (inkl. Verwaltungskostenbeitrag) und die Restmieterdarlehenszahlungen TEUR 371.

## **Derivative Finanzinstrumente**

In 2009 bestanden keine Verträge über derivative Finanzinstrumente.

## **Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Angaben zu außerbilanziellen Geschäften**

Die Gesellschaft hat unkündbare Immobilienleasingverträge für das Betriebs- und Verwaltungsgebäude, das Mitarbeiterzentrum, das Parkhaus sowie für ein weiteres Bürogebäude abgeschlossen, deren Laufzeiten sich bis 2014, 2019, 2020 und 2021 erstrecken. Es besteht jeweils ein ausgewogenes, in der Ausgestaltung marktübliches Verhältnis von Vorteilen und Risiken. Die Transaktionen dienen der Investitionsfinanzierung.

Im Rahmen des Mietvertrags mit Labrum hat ELMOS einen Immobilienleasingvertrag über ein Servicegebäude mit Kantine und Sozialflächen abgeschlossen und ist zu Restmietzahlungen bis 2014 in Höhe von TEUR 3.384 (inkl. Verwaltungskostenbeitrag) verpflichtet. Für die Dauer des Mietverhältnisses ist der Vertrag unkündbar. Nach Ablauf der Mietzeit kann ELMOS die Verlängerung des Mietvertrages um weitere fünf Jahre verlangen.

Im Rahmen des Mietvertrages mit Exedra hat ELMOS einen Immobilienleasingvertrag über ein Betriebs- und Verwaltungsgebäude abgeschlossen und ist zu Restmietzahlungen in Höhe von TEUR 21.910 (inkl. Verwaltungskostenbeitrag) zzgl. Restzahlungen für Mieterdarlehen in Höhe von TEUR 7.187 bis 2020 verpflichtet.

Im Rahmen des Mietvertrages mit Epigone hat ELMOS einen Immobilienleasingvertrag über ein Verwaltungsgebäude abgeschlossen und ist zu Restmietzahlungen in Höhe von TEUR 12.814 (inkl. Verwaltungskostenbeitrag) zzgl. Restzahlungen für Mieterdarlehen in Höhe von TEUR 3.503 bis 2021 verpflichtet.

Darüber hinaus hat die Gesellschaft Leasingverträge für technische Anlagen und Maschinen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung abgeschlossen, deren Laufzeiten sich bis 2019 erstrecken. Die Gesellschaft ist insgesamt zu Restmietzahlungen in Höhe von TEUR 16.348 verpflichtet. Des Weiteren bestehen Leasingverträge für den Fuhrpark, Büromaschinen und EDV-Ausstattung in betriebsüblichem Umfang sowie Verpflichtungen aus Rückdeckungsversicherungen. Für alle vorgenannten Transaktionen besteht jeweils ein ausgewogenes, in der Ausgestaltung marktübliches Verhältnis von Vorteilen und Risiken. Alle Transaktionen dienen der Investitionsfinanzierung.

Weiterhin hat die Gesellschaft in 2005 einen Vertrag über die Erbringung von Forschungs- und Entwicklungsleistungen sowie zur Nutzung einer Produktionslinie mit einer Laufzeit bis 2015 abgeschlossen, wobei die Dauer der Nutzung der Produktionslinie zwischenzeitlich bis 2017 verlängert wurde. Die Gesellschaft ist zu Restzahlungen

in Höhe von TEUR 27.287 verpflichtet. Die Transaktion beinhaltet ein ausgewogenes, in der Ausgestaltung marktübliches Verhältnis von Vorteilen und Risiken und bezweckt den Einkauf von F&E-Dienstleistungen und Produktionskapazitäten.

Infolge der bestehenden nichtkündbaren oben genannten Verträge summieren sich die in den folgenden Jahren zu zahlenden Beträge wie folgt:

	<u>TEUR</u>
2010	23.044
2011	15.318
2012	13.850
2013	10.382
2014	9.574
Folgejahre (gesamt)	34.856

In den angegebenen Werten sind sonstige finanzielle Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 59 enthalten, die sich auf das Geschäftsjahr 2010 beziehen.

Aus erteilten Investitionsaufträgen besteht ein Bestellobligo von TEUR 445.

## Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

### Umsatzerlöse

	2009 <u>TEUR</u>	2008 <u>TEUR</u>
- nach Sparten		
Produktion	107.986	152.821
Entwicklung	749	6.208
Sonstiges	<u>182</u>	<u>410</u>
Nettoumsatzerlöse	<u><u>108.917</u></u>	<u><u>159.439</u></u>
- nach Regionen		
Inland	42.159	62.289
Übrige EU-Länder	41.683	62.648
USA	6.046	9.131
Übrige Länder	<u>19.029</u>	<u>25.371</u>
Nettoumsatzerlöse	<u><u>108.917</u></u>	<u><u>159.439</u></u>

### Außerplanmäßige Abschreibungen

Auf Gegenstände des Sachanlagevermögens wurden im Geschäftsjahr außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von TEUR 88 vorgenommen.

### Sonstige betriebliche Erträge

Bei den periodenfremden Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (TEUR 415), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 403) und Schadenserstattungen (TEUR 148).

### Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den periodenfremden Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen aus Garantieleistungen (TEUR 1.673), Nachzahlungen von Versicherungsbeiträgen (TEUR 205), das Jahr 2008 betreffende Gutschriften (TEUR 273), Forderungsverluste (TEUR 195) sowie die Abwertung von Ersatzteilen (TEUR 400).

## **Honorare für Abschlussprüfer**

Auf die Angabe der Honorare für Abschlussprüfer wurde verzichtet. Hierzu wird auf den Konzernabschluss der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund, verwiesen.

## **Sonstige Angaben**

### **Aufsichtsrat**

Prof. Dr. Günter Zimmer, Duisburg, Diplom-Physiker, (Vorsitzender)  
Universitätsprofessor i.R.

Dr. Burkhard Dreher, Dortmund, Diplom-Volkswirt (stellvertretender Vorsitzender)  
Selbstständiger Volkswirt

Dr. Klaus Egger, Steyr-Gleink / Österreich (bestellt am 25.06.2009)  
Management Consultant

Jörns Haberstroh, Kerken, Diplom-Ökonom  
Management Consultant

Dr. Peter Thoma, Unterschleißheim, Diplom-Physiker (bis 06.05.2009)  
Consultant Automotive Electronics

Jutta Weber, Tarrytown, New York, Diplom-Pädagogin  
Erzieherin

Dr. rer. nat. Klaus Weyer, Diplom-Physiker  
Management Consultant

Herr Prof. Dr. Günter Zimmer übt ein weiteres Aufsichtsratsmandat (Dolphin Intégration S.A.), Herr Dr. Burkhard Dreher weitere zwei (Vattenfall Europe Mining AG, Arcelor Mittal Eisenhüttenstadt GmbH), Herr Jörns Haberstroh ein weiteres Mandat (Ehlebracht AG) und Herr Dr. Peter Thoma ein weiteres Mandat aus (Kromberg & Schubert GmbH & Co. KG). Herr Dr. Weyer übt zwei Aufsichtsratsmandate aus (Aufsichtsrat der Paragon AG, Projektbeirat der MST Dortmund, letzteres bis November 2009).

## **Vorstand**

Diplom-Physiker Dr. rer. nat. Anton Mindl, Lüdenscheid  
Vorstandsvorsitzender

Diplom-Ingenieur Reinhard Senf, Iserlohn  
Vorstand für Produktion

Diplom-Volkswirt Nicolaus Graf von Luckner, Oberursel  
Vorstand für Finanzen

Jürgen Höllisch, Purbach am Neusiedlersee  
Vorstand für Vertrieb und Entwicklung

## **Gesamtbezüge des Vorstands**

Die Bezüge des Vorstands teilen sich in fixe Bezüge und variable, erfolgsorientierte Bezüge auf, die sich auf Ergebnisgrößen des ELMOS Konzerns beziehen. Demnach betragen die Bezüge des Vorstands für 2009 insgesamt TEUR 1.868. Hiervon entfallen auf den fixen Bestandteil TEUR 1.141 und auf den variablen Teil TEUR 658, die aktienbasierte Vergütung (zum Zeitwert der Ausgabe) belief sich auf TEUR 69. Für Mitglieder des Vorstands bestehen mittelbare Pensionszusagen, für die aufgrund der vollständig kongruenten Rückdeckung durch eine Rückdeckungsversicherung keine Pensionsrückstellung zu bilden ist. In 2009 beliefen sich die Beiträge für diese Pensionspläne auf TEUR 347, die im fixen Bestandteil der Bezüge enthalten sind. Weiter haben die Mitglieder des Vorstands in 2009 insgesamt 99.000 Aktienoptionen erhalten. Stock Awards wurden in 2009 nicht ausgegeben, siehe auch Ausführungen zum Eigenkapital.

In der Hauptversammlung vom 19. Mai 2006 wurde mit einer  $\frac{3}{4}$ -Mehrheit beschlossen, die Angaben gemäß § 285 I Nr. 9a Satz 5 - 9 HGB für die folgenden 5 Jahre zu unterlassen.

Die Bezüge für frühere Vorstandsmitglieder bzw. ihrer Hinterbliebenen betragen im Geschäftsjahr 2009 TEUR 283. Daneben wurden für diese Versicherungsprämien in Höhe von TEUR 300 entrichtet. Die gebildete Pensionsrückstellung beträgt TEUR 1.961.

Die Mitglieder des Vorstandes halten die folgende Anzahl an Aktien der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund:

	<u>Aktien</u>	<u>Aktienoptionen</u>
Dr. Anton Mindl	103.725	33.000
Reinhard Senf	16.923	32.000
Nicolaus Graf von Luckner	10.614	22.000
Jürgen Höllisch	0	22.000

### **Gesamtbezüge des Aufsichtsrats**

Die fixen Bezüge (inkl. Spesen und Auslagen) des Aufsichtsrats beliefen sich für 2009 insgesamt auf TEUR 84, es wurde keine variable Vergütung gezahlt.

An Aufsichtsratsmitglieder wurden in 2009 keine Aktienoptionen und keine Gratisaktien ausgegeben.

Für sonstige Dienstleistungen – insbesondere Beratungen – vergütete die Gesellschaft an Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2009 TEUR 230.

Die folgenden Mitglieder des Aufsichtsrates halten die angegebene Anzahl an Aktien der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund:

	<u>Aktien</u>	<u>Aktienoptionen</u>
Prof. Dr. Günter Zimmer	29.027	0
Dr. Burkhard Dreher	5.000	0
Dr. Klaus Egger	0	0
Jörns Haberstroh	3.956	0
Jutta Weber	200	0
Dr. Klaus Weyer	72.500	10.000

## Meldepflichtige Wertpapiergeschäfte

Die folgenden meldepflichtigen Wertpapiergeschäfte fanden in 2009 statt:

Datum Ort	Name	Funktion	Transaktion	Stückzahl	Kurs / Basispreis (Euro)	Gesamtvolumen (Euro)
26.02.2009 Xetra	ZOE Beteiligungs GmbH	juristische Person in enger Beziehung zu Aufsichtsratsvorsitzendem	Erwerb von ELMOS-Aktien	27.416	1,52	41.625,71
30.06.2009 Außerbörslich	Dr. Klaus Weyer	Aufsichtsratsmitglied	Verleih von ELMOS-Aktien (Wertpapierdarlehen)	10.000	unentgeltlich	Na
30.06.2009 Außerbörslich	Dr. Klaus Weyer	Aufsichtsratsmitglied	Verleih von ELMOS-Aktien (Wertpapierdarlehen)	5.000	unentgeltlich	Na
21.12.2009 Außerbörslich	ZOE-VVG GmbH*	juristische Person in enger Beziehung zu Aufsichtsratsvorsitzendem	Erwerb von ELMOS-Aktien	742.894	nicht bezifferbar	nicht bezifferbar
21.12.2009 Außerbörslich	Weyer Beteiligungsgesellschaft mbH*	juristische Person in enger Beziehung zu Aufsichtsratsmitglied	Erwerb von ELMOS-Aktien	742.895	nicht bezifferbar	nicht bezifferbar

\* Der Aktienwerb erfolgt bei Vollzug eines am 21.12.2009 beurkundeten Spaltungs- und Übernahmevertrags nach dem Umwandlungsgesetz.

## Mitarbeiter

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter beträgt in den Funktionsbereichen:

	<u>2009</u>
Produktion	419
Vertrieb	53
Verwaltung	56
Qualitätswesen	37
Forschung & Entwicklung	<u>139</u>
	<u><u>704</u></u>

## Konzernverhältnisse

Die ELMOS Semiconductor AG, Dortmund, befindet sich im mittelbaren Mehrheitsbesitz der EFH ELMOS Finanzholding GmbH, Dortmund, die nach § 290 Abs. 2 Nr. 2 HGB zur Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet ist. Die Aufstellung eines Konzernabschlusses durch die EFH ELMOS Finanzholding GmbH, Dortmund, zum 31. Dezember 2009 erfolgte bislang nicht.

## Gewinnverwendungsvorschlag

Der Vorstand schlägt (in Übereinstimmung mit dem Aufsichtsrat) vor, den Bilanzgewinn von EUR 42.715.514,53 auf neue Rechnung vorzutragen.

## Angaben gemäß § 160 Abs. 1 Nr. 8 AktG

Die Gesellschaft hat folgende Mitteilungen gemäß § 26 Abs. 1 des WpHG veröffentlicht:

Die ZOE-BTG GmbH hat mit Schreiben vom 19. März 2009 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil am 29. Dezember 2004 die Schwelle von 10 % überschritten hat. Sie hielt am 29. Dezember 2004 somit 2.159.202 Stimmrechte an der ELMOS, was 11,1876 % des Grundkapitals entsprach. Sie hat weiter mitgeteilt, dass sie am 19. März 2009 11,8822 % des Grundkapitals der Gesellschaft hält.

Am 19. März 2009 hat die Dr. Weyer GmbH mitgeteilt, dass sie am 20. Januar 2007 bzw. am 19. März 2009 3.236.584 Stimmrechte an der ELMOS hält, was 16,6712 % des Grundkapitals entspricht.

Die Makos GmbH hat am 19. März 2009 mitgeteilt, dass sie am 20. Januar 2007 bzw. am 19. März 2009 3.236.584 Stimmrechte an der ELMOS hält, was 16,6712 % des Grundkapitals entspricht.

Die drei Gesellschaften Makos GmbH, Dr. Weyer GmbH und ZOE-BTG GmbH sind 100 %-ige Tochtergesellschaften der EFH ELMOS Finanzholding GmbH. Damit beträgt der direkte und indirekte Anteilsbesitz der EFH ELMOS Finanzholding GmbH an der ELMOS Semiconductor AG in Summe 52,9 %. Zur erfolgten Umstrukturierung der EFH ELMOS Finanzholding GmbH, als deren Folge die Gesellschaft im Januar 2010 erloschen ist, verweisen wir auf den Nachtragsbericht im Lagebericht.

Am 23. Juli 2009 hat die FMR LLC (Boston, USA) inklusive der ihr zugerechneten Stimmrechte ihrer Tochterunternehmen den Stimmrechtsanteil von 3% überschritten. Zu diesem Zeitpunkt hielt die Gesellschaft inklusive der ihr zugerechneten Stimmrechte ihrer Tochterunternehmen 3,07 % oder 595.694 Stimmrechte der ELMOS. Am 2. September 2009 hat die FMR LLC inklusive der ihr zugerechneten Stimmrechte ihrer Tochterunternehmen die Stimmrechtsschwelle von 5 % überschritten. Zu diesem Stichtag besaß die FMR LLC inklusive der ihr zugerechneten Stimmrechte ihrer Tochterunternehmen 5,03 % oder 976.190 Aktien von ELMOS.

Am 14. August 2009 hat die Fidelity Management & Research Company (Boston, USA), die ein 100%iges Tochterunternehmen der FMR LLC ist, die Stimmrechtsschwelle von 3 % erreicht. Das Unternehmen hat in der Bekanntmachung mitgeteilt, 3,15 % oder 612.350 Aktien von ELMOS zu halten. Am 22. Oktober 2009, teilte die Fidelity Management & Research Company (Boston, USA) ferner mit, 5,06 % oder 982.212 Aktien von ELMOS zu halten.

## **Erklärung gemäß § 161 AktG zum Corporate-Governance-Kodex**

Vorstand und Aufsichtsrat der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund, haben im Dezember 2009 und im Februar 2010 eine aus dem Dezember 2009 ersetzende Erklärung nach § 161 AktG abgegeben und den Aktionären auf der Internetseite der Gesellschaft jeweils dauerhaft öffentlich zugänglich gemacht.

Dortmund, im März 2010

Der Vorstand

---

Dr. Anton Mindl    Nicolaus Graf von Luckner    Reinhard Senf    Jürgen Höllisch

## Entwicklung des Anlagevermögens 2009

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				30.12.2005 EUR	31.12.2004 EUR	Kumulierte Abschreibungen		30.12.2005 EUR	Buchwerte	
	31.12.2004 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR			Zugänge EUR	Abgänge EUR		30.12.2005 EUR	31.12.2008 EUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>											
1. Software und Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte	31.284.492,69	223.333,40	1.688.911,43	0,00	33.196.737,52	20.105.538,10	2.148.593,41	0,00	22.254.131,51	10.942.606,01	11.179
2. Geleistete Anzahlungen	1.327.256,35	601.828,42	-1.688.911,43	0,00	240.173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	240.173,34	1.327
	<u>32.611.749,04</u>	<u>825.161,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33.436.910,86</u>	<u>20.105.538,10</u>	<u>2.148.593,41</u>	<u>0,00</u>	<u>22.254.131,51</u>	<u>11.182.779,35</u>	<u>12.506</u>
<b>II. Sachanlagen</b>											
1. Grundstücke und Bauten	17.547.077,29	27.411,55	118.760,09	17.531,00	17.675.717,93	7.016.315,59	1.568.405,75	4.880,09	8.579.841,25	9.095.876,68	10.531
2. Technische Anlagen und Maschinen	118.967.767,74	479.515,57	5.642.962,84	1.687.790,98	123.402.455,17	82.880.511,01	6.454.100,72	1.686.259,24	87.648.352,49	35.754.102,68	36.087
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.120.354,37	288.725,56	131.594,17	663.299,37	9.877.374,73	7.668.475,39	822.033,38	651.817,91	7.838.690,86	2.038.683,87	2.452
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.086.433,57	1.909.574,79	-5.893.317,10	658,64	7.102.032,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.102.032,62	11.086
	<u>157.721.632,97</u>	<u>2.705.227,47</u>	<u>0,00</u>	<u>2.369.279,99</u>	<u>158.057.580,45</u>	<u>97.565.301,99</u>	<u>8.844.539,85</u>	<u>2.342.957,24</u>	<u>104.066.884,60</u>	<u>53.990.695,85</u>	<u>60.156</u>
<b>III. Finanzanlagen</b>											
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	41.346.544,79	49.000,00	0,00	22.752.291,00	18.643.253,79	0,00	25.787,32	0,00	25.787,32	18.617.466,47	41.347
2. Beteiligungen	985.079,67	0,00	0,00	14.074,94	971.004,73	486.492,57	0,00	0,00	486.492,57	484.512,16	499
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	466.084,90	65.202,38	0,00	0,00	531.287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	531.287,28	466
4. Sonstige Ausleihungen	26.333.498,02	13.388.037,28	0,00	0,00	39.721.535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	39.721.535,30	26.333
5. Rückdeckungsansprüche aus Lebensversicherungen	1.741.592,00	209.713,72	0,00	78.057,52	1.873.248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873.248,20	1.742
	<u>70.872.799,38</u>	<u>13.711.953,38</u>	<u>0,00</u>	<u>22.844.423,46</u>	<u>61.740.329,30</u>	<u>486.492,57</u>	<u>25.787,32</u>	<u>0,00</u>	<u>512.279,89</u>	<u>61.228.049,41</u>	<u>70.387</u>
	<u>261.206.181,39</u>	<u>17.242.342,67</u>	<u>0,00</u>	<u>25.213.703,45</u>	<u>253.234.820,61</u>	<u>118.157.332,66</u>	<u>11.018.920,58</u>	<u>2.342.957,24</u>	<u>126.833.296,00</u>	<u>126.401.524,61</u>	<u>143.049</u>

# *Lagebericht für 2009*

## *Geschäft und Rahmenbedingungen*

### GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

ELMOS entwickelt, produziert und vertreibt hochintegrierte mikroelektronische Schaltkreise. Das Unternehmen wurde 1984 in Dortmund gegründet und hat dort seinen Hauptsitz sowie den größten Produktionsstandort. Die Produkte – sogenannte Halbleiter – werden vornehmlich in zwei Branchen eingesetzt: Rund 85% des Umsatzes wird mit Elektronik für die Automobilindustrie erzielt, die restlichen 15% werden in Produkten der Industrie- und Konsumgüterelektronik verbaut.

### ELMOS: DER SPEZIALIST FÜR AUTOMOBILELEKTRONIK

Der Anteil der Elektronik im Auto erhöht sich stetig: Komfortanwendungen wie Einparkhilfen, Klimaanlage oder Zentralverriegelungen sind heute selbstverständliche Bestandteile moderner Fahrzeuge geworden. Insbesondere die Sicherheitselektronik hat in den vergangenen Jahren Quantensprünge vollzogen. Vom ersten – noch viel diskutierten Airbag – bis zur heutigen Ausstattung mit ABS, ESP und vielen weiteren Funktionen. In den kommenden Jahren wird vor allem der geringere Kraftstoffverbrauch im Mittelpunkt stehen. Weitere Einsparungen sind hier nur durch den intelligenten Einsatz von Elektronik – auch und gerade bei der Verwendung elektrischer Antriebe – zu erzielen.

ELMOS entwickelt und produziert Halbleiter-Chips und Sensoren, also die Intelligenz für die Automobil-Elektronik. Unsere Chips regeln, steuern und messen die Systeme. Beispiel Antriebsanwendung: Hier zeichnen sich unsere Lösungen durch hochpräzise analoge Eingangsverstärker, Leistungsendstufen und integrierte Mikroprozessoren aus – alles, was eine moderne Elektronik benötigt, um das Autofahren so umweltfreundlich und effizient wie möglich zu gestalten. Daher finden sich ELMOS-Chips in fast allen Automobilmarken weltweit.

Ein Merkmal der Halbleiter für den Automobilmarkt ist die lange Produktlebenszeit. Automobile Neuprojekte benötigen in der Regel ein bis drei Jahre Entwicklungszeit, bevor sie für etwa fünf bis acht Jahre in Serie produziert werden. Teilweise verlängert sich diese Produktlebenszeit erheblich, wenn Autohersteller eine ähnliche technische Plattform in einer Familie von neuen Modellen einsetzen. ELMOS kann aufgrund von speziellen Produktionsmöglichkeiten seine Kunden – im Gegensatz zu vielen anderen Halbleiterherstellern – über einen langen Zeitraum mit demselben Chip bedienen. Weitere Merkmale unseres Geschäfts sind die sehr hohen Qualitätsanforderungen sowie die robuste Halbleitertechnologie.

Seit ihrer Gründung hat sich ELMOS eine führende Marktposition als Halbleiterhersteller im Markt für Automobilelektronik erarbeitet. Die direkten Konkurrenten sind austriamicrosystems, Melexis sowie ON Semiconductor. Bei sehr hohen Stückzahlen steht ELMOS auch in Konkurrenz zu großen Halbleiterherstellern wie Freescale, Infineon, NXP und STMicroelectronics.

### KUNDEN- UND APPLIKATIONSSPEZIFISCHE BAUSTEINE

ELMOS produziert überwiegend Produkte im Kundenauftrag für eine spezielle Anwendung exklusiv für den jeweiligen Kunden. Neben diesen kundenspezifischen Schaltkreisen (ASICs), die mehr als 90% der Produkte umfassen, verfügt ELMOS zudem über ein Portfolio von anwendungsspezifischen Standardprodukten (ASSPs). ELMOS produziert ASICs und ASSPs bislang überwiegend in eigenen Produktionsstätten (Wafer-Fabs) in Dortmund und Duisburg. Je nach Kapazitätsbedarf können in den kommenden Jahren auch zusätzlich Dienstleister die automobilen Halbleiter in unserem Auftrag (sog. Foundry-Dienstleistungen) fertigen.

### POTENZIAL IM INDUSTRIE- UND KONSUMGÜTERBEREICH

Neben dem automobilen Markt ist ELMOS im Industrie- und Konsumgüterbereich tätig und liefert Halbleiter z.B. für Anwendungen in Haushaltsgeräten, Fotoapparaten, Medizin-, Installations- und Gebäudetechnik sowie Maschinensteuerungen. Dieser nicht-automobile Bereich, insbesondere der Mikromechanikbereich, war im vergangenen Jahr nicht im selben Ausmaß wie der Automobilmarkt von der weltweiten Krise betroffen. Zudem starteten Lieferungen für Neuprojekte. Vor diesem Hintergrund stieg der Umsatz im Industrie- und Konsumgüterbereich auf einen Anteil am Konzernumsatz von 15%. Der Umsatzanteil soll mittelfristig auf 20% bis 30% steigen.

## UMFANGREICHES PRODUKTPORTFOLIO

Der Großteil des Umsatzes wird mit Halbleitern erwirtschaftet; ergänzt wird dieses Produktportfolio durch Mikro-Elektronische-Mechanische Systeme (MEMS). Hierbei handelt es sich überwiegend um hochpräzise Drucksensoren in Silizium, die durch unsere Tochtergesellschaft Silicon Microstructures (SMI)/ Milpitas, USA, entwickelt, produziert und vertrieben werden. Darüber hinaus unterstützt die produzierende Tochterfirma ELMOS Advanced Packaging B.V. (ELMOS AP) mit Sitz in Nijmegen, Niederlande, das Technologie- und Produktportfolio mit der Entwicklung und Fertigung von Spezialgehäusen für elektronische Halbleiterkomponenten und Sensoren. Die Entwicklung und Vermarktung von anwendungsspezifischen, mikro-mechatronischen Bauteilen runden die Produktpalette ab. Diese sogenannten Mikrosysteme kombinieren die Fähigkeiten der ELMOS-Gruppe und bestehen aus signalverarbeitenden Halbleiterbauelementen und mikromechanischen Sensoren in einem funktionalen Gehäuse. Damit kann der Kunde kostengünstige Systemlösungen realisieren.

## *Strategie*

Im Jahr 2009 wurde – trotz der weltweiten Krise – weiterhin die planmäßige Umsetzung der eingeschlagenen Strategie vorangetrieben. Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass sich die Investitionen in die Umsetzung unserer Strategie auch aus wirtschaftlicher Sicht bezahlt machen. Wir können auf der Basis einer soliden Liquiditätslage und bilanziellen Stärke agieren. Die strategischen Eckpfeiler und deren Fortschritte werden nachfolgend umrissen.

### VOM MASSSCHNEIDER ZUM TRENDSETTER

ELMOS hat sich als Spezialist für Lösungen im automobilen und industriellen Halbleiterumfeld einen Namen gemacht. Diese so genannten Applikationsspezifischen Integrierten Schaltkreise (ASICs) beruhen auf dem Prinzip, dass Kundenwünsche und Applikationsanforderungen identifiziert und geeignete Lösungsansätze entwickelt wurden – daher werden diese Art von Halbleitern auch „kundenspezifische Halbleiter“ genannt. In den vergangenen Jahren gibt es einen Trend zu mehr standardisierten Bauelementen. Angetrieben durch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben viele der Kunden beschlossen, zunehmend applikationsspezifische Standardprodukte – sogenannte ASSPs – einzusetzen. Frühzeitig hat ELMOS damit begonnen, entsprechende Produkte zu identifizieren und zu entwickeln. Erste ASSPs konnten bereits erfolgreich im Markt platziert werden. Die internen Strukturen wurden an die neuen Marktgegebenheiten angepasst, um gezielt und kompetent die eigene Position im Markt zu stärken sowie durch die kompetente Nähe zu vielen Kunden richtungsweisende Produkte voran zu treiben. In vielen Fällen funktioniert dies sogar unabhängig von den Märkten und Regionen, wodurch sich zusätzliche Vermarktungschancen ergeben. Zu den wichtigsten Produktlinien gehören u.a. Interface, Motorsteuerung, Sensoren und Sicherheit.

### STÄRKERER EINSTIEG IN INDUSTRIE- UND KONSUMGÜTERMÄRKTE

Unsere Stärke liegt historisch im Automobilmarkt. Wir sehen für unsere Produkte und Ingenieurleistungen jedoch auch erhebliche, bisher nicht adressierte Chancen in Industrie- und Konsumgütermärkten. Um unsere Möglichkeiten zu nutzen, haben wir unsere Anstrengungen in diesem Bereich signifikant verstärkt. Wir haben zusätzliche Distributoren unter Vertrag genommen, um eine globale Kundenbasis anzusprechen. Zudem zielen wir mit unserem eigenen auf die Industrie- und Konsumgütermärkte spezialisierten Vertriebsteam auf Schlüsselkunden in diesen Märkten. Als Erfolg konnten im vergangenen Jahr zahlreiche neue Projekte akquiriert und Neuprojekte zur Serienreife gebracht werden. Die Bereiche Netzwerksysteme, Lichtkonzepte, Sensorik und Energieversorgung stoßen auf großes Kundeninteresse. Mittelfristig sollen die nicht-automobilen Märkte 20% bis 30% des Umsatzes der ELMOS ausmachen.

### ERSCHLIESSUNG DER ASIATISCHEN MÄRKTE

Bislang sind wir stark auf dem deutschen und den weiteren europäischen Märkten aufgestellt. Im US-amerikanischen Markt haben wir Fuß gefasst und gute Kontakte etabliert. Die Erschließung des asiatischen Markts, und dabei insbesondere des japanischen und südkoreanischen, haben wir in den letzten Jahren forciert. Hierzu haben wir unsere Vertriebsaktivitäten durch eigene Mitarbeiter und Repräsentanten gestärkt und strategische Partnerschaften mit asiatischen Unternehmen geschlossen. Diese Aktivitäten haben dazu geführt, dass wir wiederum zahlreiche Design Wins verbuchen konnten und neue Produkte die Serienfreigabe erhalten haben. Dies führt dazu, dass schon 2010 ein im Vergleich zu 2009 deutlich größerer Umsatzanteil mit asiatischen Kunden generiert wird.

## EINSTIEG IN STRATEGISCHE PARTNERSCHAFTEN

Durch strategische Kooperationen mit Partnern können wir unsere eigenen Fähigkeiten sinnvoll ergänzen, um langfristig ein breiteres Produktportfolio anbieten zu können und damit unsere Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. 2007 haben wir zwei Partnerschaften vertraglich vereinbart. Einerseits unterzeichneten wir einen Kooperationsvertrag mit der koreanischen Foundry MagnaChip. Gemeinsam entwickeln wir zum einen eine neue Technologiegeneration und zum anderen ermöglicht uns diese Partnerschaft, fertig prozessierte Wafer zu beziehen, um dadurch mittelfristig unseren Investitionsbedarf zu reduzieren und flexibler auf stark schwankende Stückzahlen reagieren zu können. Wir haben unseren Automotive-Prozess zu MagnaChip transferiert und werden 2010 mit der Produktion beginnen. Diese zusätzlichen Fremdfertigungskapazitäten ermöglichen ELMOS in Kombination mit der eigenen Produktion die Umsetzung eines sog. Fab-light Konzepts. Andererseits haben wir mit NEC Electronics einen Vertrag geschlossen, der die gemeinsame Entwicklung, die wechselseitige Nutzung von Entwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen sowie die gemeinschaftliche Vermarktung von Produkten für den Automobil- und Industriemarkt umfasst. Die Kunden beider Unternehmen werden insbesondere davon profitieren, dass die Stärken der NEC Electronics im Bereich von 8- bis 32-bit Mikrocontrollern, mit den robusten und zuverlässigen, anwendungsspezifischen analog/mixed-signal Halbleiterchips von ELMOS kombiniert werden können. Ein erstes Produkt ist ein Baustein für ein neues Kommunikationssystem in der Industrieautomatisierung namens IO-Link.

## GRÖßERER ANTEIL AN MIKROSYSTEMEN

Mikrosysteme, bestehend aus ASICs/ASSPs und MEMS in einem kundenspezifischen Package, werden in den kommenden Jahren eine steigende Nachfrage erfahren. ELMOS ist als eines der wenigen Unternehmen in der Lage, Mikrosysteme in der ELMOS-Gruppe vollständig zu entwickeln und zu produzieren. In den vergangenen Geschäftsjahren wurde die Entwicklung der Mikrosystem-Projekte soweit vorangetrieben, dass in 2009 ein Mikrosystem für eine Sicherheitsanwendung in Serie gegangen ist. Zudem steht nun ein erstes Standard-Mikrosystem, ein für die Industrie-, Medizin- und Automobilmärkte einsetzbares Drucksensorsystem, für Kunden zur Verfügung.

## *Wirtschaftliche Rahmenbedingungen*

Der für ELMOS wichtigste Markt ist der der Halbleiter für die Automobilindustrie, ein Nischenmarkt der globalen Halbleiterindustrie. Er umfasst zwischen 7% und 8% des weltweiten Halbleitermarktes.

### AUTOMOBILINDUSTRIE

In **Deutschland** entwickelten sich die Pkw-Neuzulassungen aufgrund der Umweltprämie für Altfahrzeuge („Abwrackprämie“) positiv. Im Gesamtjahr 2009 wurden laut dem Verband der deutschen Automobilhersteller (VDA) in Deutschland 3,8 Mio. Pkw neu zugelassen (+23%). Nur zwei weitere westeuropäische Märkte entwickelten sich gegenüber dem Vorjahr positiv: Frankreich (+10,7%) und Österreich (+8,8%). In den anderen Ländern in Westeuropa sanken die Zulassungszahlen der Pkws, z.B. Italien (-0,2%), Großbritannien (-6,4%) und Spanien (-17,9%). Insgesamt blieb der Markt in Westeuropa im Vergleich zu 2008 stabil bei 13,6 Mio. Fahrzeugen (+0,5%).

Der **US-Markt** ist 2009 – trotz eines Subventionsprogrammes („Cash for Clunkers“) – auf Jahressicht eingebrochen. Laut VDA wurden gegenüber dem Vorjahr 21% weniger Pkws abgesetzt. Insgesamt hatte der US-Markt ein Volumen von 10,4 Mio. Fahrzeugen. Im Zwei-Jahresvergleich wird das Ausmaß des Einbruches noch deutlicher. Im Vergleich zum Absatzvolumen des Jahres 2007 (16,1 Mio. Fahrzeuge) wurden 2009 rund 5,7 Mio. Fahrzeuge weniger verkauft. Dies ist ein Rückgang um mehr als ein Drittel.

Die **asiatischen Märkte** waren 2009 die Wachstumsmotoren der weltweiten Automobilindustrie. An der Spitze lag der Absatz auf dem chinesischen Markt. Angetrieben von staatlichen Kaufanreizen wuchs der Autoabsatz im Jahr 2009 um 54% auf rund 13,6 Mio. Fahrzeuge. Damit hat China die USA als weltgrößten Absatzmarkt überholt. Indien konnte 2009 ebenfalls ein beachtliches Wachstum von 17% auf rund 2 Mio. Pkw vorweisen.

Für 2010 rechnet der VDA für Deutschland mit einem deutlichen Rückgang nach dem außergewöhnlichen Zulassungsjahr 2009 mit Sonderfaktoren wie der Abwrackprämie. Der inländische Pkw-Markt soll demnach 2010 auf 2,75 bis 3,0 Mio. Neuzulassungen nachgeben. Der VDA sieht darin aber nur einen Rückgang auf das deutsche Normalmaß bzw. auf einen Wert nur wenig unter dem langjährigen Durchschnitt des deutschen Automarkts. Weltweit ist mit einer leichten Erholung zu rechnen. Der chinesische Markt soll wiederum deutlich wachsen, um mindestens 10% gegenüber 2009. Für die USA rechnet der VDA ebenfalls mit einem Zuwachs um 10% gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt soll die weltweite Automobilproduktion in 2010 rund 55 Mio. Fahrzeuge umfassen (2009: 53 Mio. Fahrzeuge).

#### AUTOMOBILER HALBLEITERMARKT

In der Regel wächst der automobiler Halbleitermarkt selbst bei konstanter Automobilproduktion. Dies ist begründet durch den stetig steigenden Anteil elektronischer Systeme im Automobil. Die Trendanalyse des Zentralverbandes der Elektroindustrie (ZVEI) geht davon aus, dass vor allem im Antriebsstrang die Mikroelektronik weltweit auch in den nächsten fünf Jahren zweistellige Wachstumsraten erreichen wird. Der Insassenschutz ist ein anderes Teilgebiet mit hohen Wachstumsraten.

Der Halbleiterverbrauch im Auto wird global weiter steigen, so die ZVEI-Trendanalyse. 2008 wurden für rund 300 US-Dollar Halbleiter in ein Auto eingebaut, 2013 sollen es 400 US-Dollar sein. Für den Nischenmarkt der automobilen Halbleiter prognostiziert das Marktforschungsunternehmen Semicast für 2010 ein Wachstum von 16% gegenüber 2009.

### *Produktion*

Die EL MOS Semiconductor AG betreibt Halbleiterfertigungen in Dortmund und Duisburg. Die Fertigung am Hauptsitz in Dortmund produziert auf 150mm-Wafern (entspricht 6-Zoll), der Standort in Duisburg fertigt die Halbleiter auf 200mm-Wafern (entspricht 8-Zoll). Im Dortmunder Testbereich werden Wafer und verpackte Bauteile elektrischer Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass nur spezifikationsgerechte Erzeugnisse an die Kunden geliefert werden. Neben den beiden Halbleiterfertigungen hat EL MOS weitere Fertigungsanlagen: Am Produktionsstandort Nijmegen, Niederlande, fokussiert sich die Tochtergesellschaft EL MOS Advanced Packaging schwerpunktmäßig auf die Tätigkeitsfelder Gehäuseentwicklung und Fertigung von Sondergehäusen für mikromechanische Systeme (MEMS) sowie Gurtung und Verpackung (Tape & Reel). Bei der Tochtergesellschaft SMI in Milpitas, Kalifornien, werden in einer eigenen 6-Zoll Fertigung MEMS-Drucksensoren gefertigt.

Der Umsatz des EL MOS Konzerns war, insbesondere im ersten Halbjahr 2009 bedingt durch die weltweite Krise, signifikant rückläufig. An den beiden Fertigungsstandorten Dortmund und Duisburg wurde die Wafereinstellung aus wirtschaftlichen Gründen zurückgefahren. Dementsprechend sank die Anzahl der produzierten Chips gegenüber dem Vorjahr. Durch die Einführung von Kurzarbeit, konsequente Sparmaßnahmen und die Umsetzung effizienzsteigernder Maßnahmen sind die Produktionskosten gesunken; allerdings aufgrund der hohen Fixkosten einer Halbleiterfertigung nicht in gleichem Maße wie die produzierten Chipmengen. Als ein Teil des Sparmaßnahmenpakets wurden Investitionen zum Kapazitätsausbau verschoben. Die vorgesehene Umstellung eines Teils der Fertigung in Dortmund von 150mm auf 200mm wurde im zweiten Halbjahr mit strukturellen Arbeiten wieder aufgenommen. Dazu gehört beispielsweise die Inbetriebnahme von Ausrüstungen, die für neue Prozesse bzw. neue 8-Zoll-Wafer benötigt werden. Wir binden das Wissen und die Erfahrungen, welche wir mit unserer 8-Zoll-Fertigung in Duisburg gewonnen haben, intensiv in die Planungen und Aktivitäten ein; so haben wir z.B. schon jetzt einige Back-up-Lösungen für Duisburg am Standort Dortmund etabliert. Mit der teilweisen Umrüstung sichern wir die Wettbewerbsfähigkeit der Dortmunder Fertigung auch im internationalen Vergleich.

Die eigenen Fertigungsstätten werden komplettiert durch Kooperationen mit Auftragsfertigungen (Foundries). Zukünftig stellen diese zusätzlich benötigte Kapazitäten zur Verfügung und ermöglichen es EL MOS, flexibel auch auf stärker schwankende Nachfrage reagieren zu können. Die Möglichkeit der Produktion bei einem Foundry-Partner soll insbesondere auch für ASSPs und für Produkte im Industrie- und Konsumgüterbereich wahrgenommen werden.

## *Forschung und Entwicklung*

Die immer intensivere Nutzung und steigende Komplexität von elektronischen Komponenten im Automobil führt zu kontinuierlich wachsenden Anforderungen der Automobilindustrie an Qualität und Zuverlässigkeit der Automobilelektronik. Die Elektronikbausteine werden zusätzlich zu den Qualifikationen nach internationalen Standards durch eigene Qualifikationsverfahren geprüft, um das in der Automobilindustrie hohe Qualitätsniveau sicherzustellen. Parallel wird das in der Automobilelektronik gewonnene Know-how für den Ausbau der Aktivitäten in der Industrielektronik genutzt.

Im Mittelpunkt der Entwicklungstätigkeiten der ELMOS steht der marktgerechte Ausbau des Produktportfolios. Der Großteil der Produktentwicklungskosten, die bei ELMOS anfallen, wird von der Gesellschaft vorfinanziert und muss sich über die Serienfertigung amortisieren. Dies trifft natürlich in besonderem Maße für die Entwicklung von applikationsspezifischen Standardprodukten zu, die zukünftig einen größeren Umsatzanteil von ELMOS ausmachen werden. Die Bereitstellung der finanziellen Mittel für diese in die Zukunft gerichteten Projekte hatte einen ganz besonderen Stellenwert in der Wirtschaftskrise.

Schwerpunkt der Prozessentwicklung war die Erweiterung der 0,35µm Prozessfamilie.

## *Mitarbeiter*

Das Know-how der Mitarbeiter ist für ELMOS als Technologieunternehmen in besonderem Maße entscheidend. Deren Motivation, Wissen und Flexibilität sind die Voraussetzung für den langfristigen Erfolg des Unternehmens. Besonders in der Entwicklung neuer Produkte und Verfahren sind die Mitarbeiter das entscheidende Kriterium für das Wachstum und die Innovationskraft. An den Standorten Dortmund und Duisburg in Nordrhein-Westfalen, im bevölkerungsreichsten Bundesland, kann ELMOS auf eine große Zahl von gut ausgebildeten Jungingenieuren zugreifen, denn im näheren Umkreis befinden sich mehr als fünfzig Universitäten und Hochschulen. Schon seit der Gründung kooperiert ELMOS eng mit diesen und genießt als einziger Halbleiterhersteller der Region eine Ausnahmestellung. ELMOS bildet in zahlreichen technischen und kaufmännischen Berufen aus, mit Schwerpunkt auf dem Beruf des Mikrotechnologen. Ende 2009 waren 36 (2008: 46) Auszubildende am Hauptstandort Dortmund beschäftigt.

Die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Mitarbeitern erfolgt vertrauensvoll mit Unterstützung einer Mitarbeitervertretung. In Ausschüssen werden die Belange der Mitarbeiter untereinander und im Verhältnis zum Vorstand besprochen und geregelt. So gibt es Ausschüsse für soziale Fragen, Personalangelegenheiten, Mitarbeiter-förderung und Wirtschaft.

### **MITARBEITERBETEILIGUNG**

In 2009 wurde - nach den Aktienoptionsprogrammen 1999 und 2004 - wiederum ein Aktienoptionsprogramm beschlossen. Aktienoptionen stellen unverändert einen wichtigen und üblichen Bestandteil eines modernen Vergütungssystems und ein geeignetes Mittel zum Leistungsanreiz und zur langfristigen Bindung von Mitarbeitern dar. Der Börsenkurs ist für unsere Aktionäre ein zentrales Kriterium zur Beurteilung der Rendite bei einer Investition in das Unternehmen. Die Anknüpfung an den Börsenkurs soll daher auch weiterhin der Leistungsanreiz der Bezugsberechtigten im Rahmen des neuen Aktienoptionsplans bleiben. Die bisherige Ausübungshürde und das absolute Erfolgsziel von mindestens 5% wurde dabei allerdings auf 50% erhöht, damit die Bezugsrechte erst dann ausgeübt werden können, wenn der Unternehmenswert sehr deutlich gesteigert wurde. Außerdem wird der Vermögensvorteil, den die Bezugsberechtigten durch die Ausübung der Bezugsrechte erzielen können, auf das Vierfache des bei Ausgabe der Bezugsrechte festgesetzten Ausübungspreises begrenzt.

Auf der Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung 2009 zur Einführung eines Aktienoptionsplans haben Aufsichtsrat und Vorstand im Juni 2009 beschlossen, insgesamt 495.000 Optionen auszugeben. Der Ausübungspreis beträgt 150% des Mittelwerts der Schlussauktionspreise der Aktien der ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft im Xetra Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse an den zehn Handelstagen vor den Beschlüssen und entspricht 3,68 Euro. Die Wartefrist beträgt drei Jahre ab dem Ausgabebetrag. Die Gesellschaft ist berechtigt, den Bezugsberechtigten anstelle der Lieferung der Aktien einen Barausgleich anzubieten.

Zum 31. Dezember 2009 stehen insgesamt 627.106 Optionen aus Aktienoptionsprogrammen der Jahre 2005 und 2009 aus (31. Dezember 2008: 409.916 aus Programmen der Jahre 2004 und 2005). Nähere Informationen zu den verschiedenen Tranchen der Optionsprogramme finden sich im Anhangabschnitt „Eigenkapital“.

## *Qualität*

Im Rahmen von kontinuierlichen Verbesserungsprozessen setzt ELMOS konsequent seine First-Time-Right- und Null-Fehler-Strategie um. ELMOS erzielt damit ein hervorragendes Qualitätsniveau sowohl in seinen Produkten als auch in seinen Geschäfts- und Produktionsprozessen. Durch vorausschauende Qualitätsplanung und Überwachung der Kundenanforderungen schon in der Entwicklungsphase wird Qualität nicht nachträglich durch Selektion erreicht, sondern von Beginn an wettbewerbsfähig mit minimiertem Ausschuss produziert.

Regelmäßige Prüfungen der eingesetzten Prozesse und Werkzeuge, die lückenlose Betreuung der Serienprodukte von der Akquisition über die Entwicklung bis zur Fertigung und Lieferung, ständige Analysen und modernste statistische Verfahren ermöglichen dieses hohe Qualitätsniveau. Durch eine ausgefeilte Rückverfolgbarkeit ist ELMOS in der Lage, Ursachen kleinster Qualitätsschwankungen frühzeitig zu erkennen und deren Folgen wirksam und nachhaltig zu minimieren und die Kunden effizienter zu unterstützen. Interne Labore prüfen nicht nur mögliche Fehlermechanismen der Halbleiterfertigung, sondern auch Sensor- und Gehäuse-spezifische Merkmale und schließen so den Regelkreis zur kontinuierlichen Verbesserung der ELMOS-Produktionsprozesse.

Das ELMOS Qualitätsmanagementsystem wird jährlich gemäß den Anforderungen der DIN ISO 9001 und der Normen QS 9000 und VDA 6.1 auditiert. Diese Normen wurden in der ISO/TS 16949:2002, die weltweite Gültigkeit hat, zusammengefasst. Die wesentlichen Standorte der ELMOS-Gruppe wurden in 2009 gemäß dieser Norm auditiert und zertifiziert.

## *Beziehungen zu verbundenen Unternehmen*

Bis zum 31. Dezember 2009 war die ELMOS Finanzholding GmbH (EFH) mit einem mittelbaren und unmittelbaren Anteilsbesitz von 52,9% größter Einzelaktionär der ELMOS Semiconductor AG. Daher hat der Vorstand gemäß §§312/313 AktG einen Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgestellt, der mit folgender Erklärung gemäß §312 Abs. 3 AktG abschließt: „Wir erklären gemäß §312 Abs. 3 AktG, dass sich im Geschäftsjahr 2009 keine berichtspflichtigen Vorgänge ereignet haben.“

Nach dem Bilanzstichtag haben die Gesellschafter der EFH eine Umstrukturierung der EFH beschlossen, als deren Folge die EFH erloschen ist. Nähere Informationen finden sich im Nachtragsbericht.

## *Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage*

### KENNZAHLEN DER ELMOS SEMICONDUCTOR AG NACH HGB

in Mio. Euro oder %, soweit nicht anders angegeben	2008	2009	Veränderung
Umsatzerlöse	159,4	108,9	-31,7%
Materialaufwand	69,5	41,2	-40,7%
Personalaufwand	39,0	32,6	-16,5%
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens und Sachanlagen	13,8	11,0	-20,6%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	50,7	43,8	-13,7%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1,2	6,3	na
Jahresergebnis	-2,9	6,0	na

## *Umsatz- und Ertragsentwicklung*

Die weltweite Krise der Automobil- und Finanzbranche, welche ELMOS Ende 2008 erreichte, setzte sich auch in 2009 fort. Insbesondere im ersten Halbjahr 2009 waren die Umsatzerlöse von der Krise beeinflusst. So wurden in diesem Zeitraum massiv Bestände in der Lieferkette abgebaut. Allerdings wurden im Verlauf des ersten Halbjahres zunehmend auch Nachbestellungen getätigt, was auf eine schrittweise Leerung der Kunden-Läger oder auf die Wirkung der in verschiedenen Märkten eingeführten Abwrackprämien schließen ließ. Die erwartete Belebung des Marktes startete zu Beginn des zweiten Halbjahres 2009 und hielt bis zum Ende des Jahres an. Im zweiten Halbjahr waren vor allem folgende Umstände besonders hervorzuheben: Das Stammgeschäft verzeichnete einen Anstieg, der Start von Neuprojekten verlief positiv und ELMOS konnte die Kunden entsprechend ihren Anforderungen vollständig beliefern. Dies war bei der volatilen Umsatzentwicklung nicht selbstverständlich – viele Halbleiterunternehmen konnten die sich schnell und stark erhöhten Bedarfe im zweiten Halbjahr nicht vollständig bedienen – und hat das Kundenvertrauen in ELMOS als Partner weiter gestärkt. Insgesamt erzielte ELMOS einen Umsatz in Höhe von 108,9 Mio. Euro (2008: 159,4 Mio. Euro), was einem Rückgang von 31,7% entspricht.

Die Ertragslage ist wesentlich durch die weltweite Krise und den damit verbundenen Umsatzrückgang gekennzeichnet. Da die rückläufige Entwicklung frühzeitig antizipiert wurde, sind bereits im Herbst 2008 Kosteneinsparmaßnahmen initiiert worden, um die Auswirkungen des Umsatzrückganges auf die Ertragslage abzuschwächen. Die Maßnahmen umfassten die Verringerung und Verschiebung von Investitionen, Reduktion in allen Kostenpositionen, Neuverhandlung von Liefer- und Dienstleistungsverträgen, Kurzarbeit, Beendigung eines Großteils der Leiharbeitsverhältnisse, Verzögerung der Fertigungsumstellung von 6- auf 8-Zoll-Wafer (Standort Dortmund). Im Vergleich zum Rückgang der Umsatzerlöse (-31,7%) konnte der Materialaufwand überproportional reduziert werden (-40,7%), und zwar gleichmäßig in den Bereichen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren sowie bei den bezogenen Leistungen. Die Positionen Personalaufwand (-16,5%), Abschreibungen (-20,6%) sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (-13,7%) konnten zwar reduziert werden, aber aufgrund stärkeren Fixkostencharakters nicht im Gleichschritt mit dem Umsatzrückgang. Des Weiteren wirkte der Bestandsabbau über weite Teile des Jahres belastend. Zu Ende des Jahres 2009 hat sich das Verhältnis zwischen Produktionsleistung und Umsatzerlösen im Wesentlichen normalisiert.

Trotz des negativen operativen Ergebnisses ergab sich auf Ebene des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit mit 6,3 Mio. Euro (2008: -1,2 Mio. Euro) ein Wechsel in den positiven Bereich, der wesentlich auf Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen zurückzuführen ist. Insgesamt ergab sich dadurch in 2009 ein positives Jahresergebnis mit 6,0 Mio. Euro (2008: -2,9 Mio. Euro).

## Finanzlage

### KENNZAHLEN DER ELMOS SEMICONDUCTOR AG NACH HGB

in Mio. Euro, soweit nicht anders angegeben	2008	2009	Veränderung
Jahresergebnis	-2,9	6,0	na
Abschreibungen / Zuschreibungen	13,8	11,0	-20,6%
Veränderung von Rückstellungen und Gewinn/Verlust aus Anlagenabgängen	5,8	-1,0	na
Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-10,5	31,8	na
<b>Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva</b>	<b>20,4</b>	<b>-40,3</b>	<b>na</b>
<b>Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>26,8</b>	<b>7,5</b>	<b>-72,0%</b>
<b>Cash Flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-23,7</b>	<b>-2,9</b>	<b>87,9%</b>
<b>Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>na</b>
Abnahme/Zunahme der Finanzmittel	3,1	4,6	52,0%
<b>Finanzmittel am Ende der Periode</b>	<b>40,2</b>	<b>44,8</b>	<b>11,6%</b>

#### CASH FLOW AUS DER LAUFENDEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

Der operative Cash Flow profitierte von einem positiven, durch Erträge aus Beteiligungen geprägten Jahresergebnis. Gegenläufig wirkten die um 2,9 Mio. Euro verringerten Abschreibungen aufgrund des niedrigen Investitionslevels. Weiterhin wirkte sich der deutliche Umsatzrückgang aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise auf den operativen Cash Flow nachhaltig aus. Durch den im Vergleich zur Reduzierung der Vorräte und Forderungen aus Lieferungen & Leistungen stärkeren Rückgang der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie gegenüber verbundenen Unternehmen wurde der operative Cash Flow belastet. Insgesamt reduzierte sich der operative Cash Flow um 19,3 Mio. Euro oder 72,0% auf 7,5 Mio. Euro.

#### CASH FLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Die starke Investitionsdisziplin hat dazu geführt, dass die Investitionen in das Sachanlagevermögen sich in 2009 auf nur 2,7 Mio. Euro bzw. 2,5% vom Umsatz beliefen (2008: 14,6 Mio. Euro bzw. 9,2%). Der Cashbedarf aus der Investitionstätigkeit belief sich in 2009 auf 2,9 Mio. Euro (2008: 23,7 Mio. Euro). Dieser konnte trotz des deutlich reduzierten operativen Cash Flow auf Basis der Innenfinanzierungskraft getragen werden, so dass ein positiver, um 1,5 Mio. Euro verbesserter Free Cash Flow in Höhe von 4,6 Mio. Euro (2008: 3,1 Mio. Euro) erzielt wurde. Somit konnte sogar im Krisenjahr 2009 das Ziel eines positiven Free Cash Flow erreicht werden.

#### CASH FLOW AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Der Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit war in 2009 wie im Vorjahr ausgeglichen. Unter Berücksichtigung der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 0,4 Mio. Euro konnten die Finanzmittel nochmals um 4,6 Mio. Euro auf 44,8 Mio. Euro zum 31. Dezember 2009 gesteigert werden. Der Anteil der liquiden Mittel an den Gesamtaktiva erhöhte sich auf 19,9% (2008: 15,3%).

#### SONSTIGE FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN UND ANGABEN ZU AUSSERBILANZIELLEN GESCHÄFTEN / FINANZIERUNGSTRUMENTEN

Neben klassischen Darlehen und Krediten finanziert die Gesellschaft ihre Investitionen in Immobilien, technische Anlagen und Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie für die Nutzung von Entwicklungskapazitäten und einer Produktionslinie durch Leasing-, Miet- und Dienstleistungsverträge. Es besteht jeweils ein ausgewogenes, in der Ausgestaltung marktübliches Verhältnis von Vorteilen und Risiken. Die hieraus bestehenden Rückzahlungsverpflichtungen bilden sich in den sonstigen finanziellen Verpflichtungen ab. Am 31. Dezember 2009 betragen diese 107,0 Mio. Euro (31. Dezember 2008: 126,5 Mio. Euro).

## Vermögenslage

## KENNZAHLEN DER ELMOS SEMICONDUCTOR AG NACH HGB

in Mio. Euro, soweit nicht anders angegeben	31.12.2008	31.12.2009	Veränderung
Anlagevermögen	143,0	126,4	-11,6%
Vorräte	32,8	27,0	-17,4%
Forderungen und sonstige Vermögenswerte	40,8	23,9	-41,4%
Flüssige Mittel	40,2	45,2	12,5%
Übrige Aktiva	5,4	4,7	-11,9%
<b>Aktiva, gesamt</b>	<b>262,1</b>	<b>227,3</b>	<b>-13,3%</b>
Eigenkapital	141,0	147,0	4,3%
Verbindlichkeiten	105,9	66,0	-37,7%
Übrige Passiva	15,1	14,3	-5,3%
<b>Passiva, gesamt</b>	<b>262,1</b>	<b>227,3</b>	<b>-13,3%</b>

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2009 ist um 13,3% auf 227,3 Mio. Euro zurückgegangen (2008: 262,1 Mio. Euro). Auf der Aktivseite sind für die Entwicklung insbesondere der Rückgang der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (-9,7 Mio. Euro), der Vorräte (-5,8 Mio. Euro) sowie der Sachanlagen (-6,2 Mio. Euro) verantwortlich. Letztere sanken, weil die Abschreibungen die Neuinvestitionen im Jahr 2009 deutlich überstiegen.

Auf der Passivseite begründet sich der Rückgang der Bilanzsumme im Wesentlichen in der deutlichen Reduzierung der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (-37,0 Mio. Euro) sowie im Weiteren die Absenkung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (-3,6 Mio. Euro), gegenläufig ist aufgrund der positiven Ergebnissituation die Erhöhung des Eigenkapitals (6,0 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote verbesserte sich zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2009 deutlich auf 64,7% (2008: 53,8%).

### GESAMTAUSSAGE ZUR WIRTSCHAFTLICHEN LAGE

Die solide Finanzierung der Gesellschaft hat sich – gerade in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten – sehr bewährt. Der Großteil der Kredite ist langfristig und in den Jahren 2012 und 2013 zurückzuzahlen. Trotz des starken Umsatzrückgangs in 2009 ist es der Gesellschaft gelungen, den Nettobarmittelbestand und die Barmittel gegenüber dem Vorjahresresultimo sogar noch zu erhöhen. Die aufgrund der Finanzierung und durch die Barmittel bestehende Unabhängigkeit der Gesellschaft bietet ein solides Fundament, um ihre Wettbewerbsposition auch nach Bewältigung der Krise weiter zu stärken.

*Berichterstattung nach § 289 Abs. 4 HGB*

*zugleich erläuternder Bericht nach §176 Abs. 1 Satz 1 AktG*

### ZUSAMMENSETZUNG DES GEZEICHNETEN KAPITALS

Das in der Bilanz zum 31. Dezember 2009 aus 19.414.205 auf den Inhaber lautenden, nennwertlosen Stückaktien bestehende Grundkapital in Höhe von 19.414.205 Euro ist voll eingezahlt. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.

### BESCHRÄNKUNGEN, DIE STIMMRECHTE ODER DIE ÜBERTRAGUNG VON AKTIEN BETREFFEN

Stimmrechts- und Übertragungsbeschränkungen bestehen nicht.

## DIREKTE ODER INDIREKTE BETEILIGUNGEN AM KAPITAL

Die Beteiligungsverhältnisse stellen sich bis zum 31. Dezember 2009 wie folgt dar:

	<b>Sitz/Land der Gesellschaft</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>
EFH ELMOS Finanzholding GmbH	Dortmund/Deutschland	1.485.789	7,7
Makos GmbH	Dortmund/Deutschland	3.236.584	16,7
Dr. Weyer GmbH	Schwerte/Deutschland	3.236.584	16,7
ZOE-BTG GmbH	Duisburg/Deutschland	2.306.833	11,9
Streubesitz		9.148.415	47,1
		19.414.205	100,0

Die drei Gesellschaften Makos GmbH, Dr. Weyer GmbH und ZOE-BTG GmbH sind 100%ige Tochtergesellschaften der EFH ELMOS Finanzholding GmbH. Damit beträgt der direkte und indirekte Anteilsbesitz der EFH ELMOS Finanzholding GmbH an der ELMOS Semiconductor AG zum 31. Dezember 2009 in Summe 52,9%.

Die Gesellschafter der EFH ELMOS Finanzholding GmbH, die Dr. Weyer GmbH & Co. Vermögensverwaltung KG, die ZOE GmbH & Co. KG und die Jumakos GmbH & Co. KG, haben im Dezember 2009 eine Umstrukturierung der EFH ELMOS Finanzholding GmbH im Wege einer Aufspaltung nach dem Umwandlungsgesetz beschlossen, als deren Folge die EFH ELMOS Finanzholding GmbH am 26. Januar 2010 erloschen ist. Die vormals von der EFH ELMOS Finanzholding GmbH unmittelbar und (über ihre 100%-igen Tochtergesellschaften Dr. Weyer GmbH, ZOE-BTG GmbH und Makos GmbH) mittelbar gehaltenen Aktien der Gesellschaft sind im Zuge dieser Aufspaltung jeweils auf Gesellschaften übergegangen, die ihrerseits von der Dr. Weyer GmbH & Co. Vermögensverwaltung KG, der ZOE GmbH & Co. KG und der Jumakos GmbH & Co. KG kontrolliert werden. Nach Wirksamwerden der Aufspaltung der EFH ELMOS Finanzholding GmbH am 26. Januar 2010 verteilen sich die vormals von der EFH ELMOS Finanzholding GmbH unmittelbar und mittelbar gehaltenen Aktien der Gesellschaft damit auf die Gesellschafter der (erloschenen) EFH ELMOS Finanzholding GmbH, namentlich die Dr. Weyer GmbH & Co. Vermögensverwaltung KG (20,5%), die Jumakos GmbH & Co. KG (16,7%) und die ZOE GmbH & Co. KG (15,7%). Diese Stimmrechtsanteile werden von den Gesellschaften jeweils mittelbar gehalten.

## INHABER VON AKTIEN MIT SONDERRECHTEN

Aktien mit Sonderrechten wurden nicht ausgegeben.

## ART DER STIMMRECHTSKONTROLLE IM FALLE VON ARBEITNEHMERBETEILIGUNGEN

Dieser Punkt trifft auf die Gesellschaft nicht zu.

## GESETZLICHE VORSCHRIFTEN UND SATZUNGSBESTIMMUNGEN ÜBER DIE ERNENNUNG UND ABERUFUNG VON VORSTANDSMITGLIEDERN UND ÜBER SATZUNGSÄNDERUNGEN

Wir verweisen auf die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften für die Bestellung und Abberufung von Mitgliedern des Vorstands (§§84, 85 AktG) sowie für die Änderung der Satzung (§§133, 179 AktG). Ergänzende Bestimmungen aus der Satzung ergeben sich nicht.

## BEFUGNISSE DES VORSTANDS ZUR AUSGABE UND ZUM RÜCKKAUF VON AKTIEN

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 18. Mai 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 9.650.000 Euro durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 9.650.000 Stück neuer, auf den Inhaber lautender Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen und gem. §204 AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Ausgabe zu entscheiden (**Genehmigtes Kapital I**).

Das Grundkapital ist um bis zu 264.672 Euro bedingt erhöht (**Bedingtes Kapital 1999**). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Führungsorgane und an Mitarbeiter verbundener Unternehmen (Aktienoptionsprogramm 1999). Sie wird nur insoweit durchgeführt, wie im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 1999 der Gesellschaft nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 22. September 1999 Optionsrechte ausgegeben werden und die Inhaber dieser Optionsrechte diese ausüben. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Optionsrechten entstehen, am Gewinn teil.

Das Grundkapital ist um bis zu 145.244 Euro bedingt erhöht (**Bedingtes Kapital 2004**). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Führungsorgane und an Mitarbeiter verbundener Unternehmen (Aktienoptionsplan 2004). Sie wird nur insoweit durchgeführt, wie im Rahmen des Aktienoptionsplans 2004 nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 27. April 2004 Optionsrechte ausgegeben werden und die Inhaber dieser Optionsrechte diese wirksam ausüben. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie durch Ausübung von Optionsrechten entstehen, am Gewinn teil.

Das Grundkapital ist um bis zu 3.900.000 Euro bedingt erhöht (**Bedingtes Kapital 2009/I**). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Wandel- oder Optionsanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. einer Kombination dieser Instrumente), die von der ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft oder einer Konzerngesellschaft der ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft im Sinne von §18 AktG aufgrund der von der Hauptversammlung vom 6. Mai 2009 unter Tagesordnungspunkt 7 b) beschlossenen Ermächtigung I bis zum 5. Mai 2014 ausgegeben werden, von ihren Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur Wandlung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung erfüllen, soweit nicht ein Barausgleich gewährt wird oder eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Wandlungs- bzw. Optionspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie aufgrund der Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. der Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

Das Grundkapital ist um weitere bis zu 3.900.000 Euro bedingt erhöht (**Bedingtes Kapital 2009/II**). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Wandel- oder Optionsanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. einer Kombination dieser Instrumente), die von der ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft oder einer Konzerngesellschaft der ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft im Sinne von §18 AktG aufgrund der von der Hauptversammlung vom 6. Mai 2009 unter Tagesordnungspunkt 7 c) beschlossenen Ermächtigung II bis zum 5. Mai 2014 ausgegeben werden, von ihren Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur Wandlung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung erfüllen, soweit nicht ein Barausgleich gewährt wird oder eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Wandlungs- bzw. Optionspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie aufgrund der Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. der Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

Das Grundkapital ist um bis zu 1.000.000 Euro bedingt erhöht (**Bedingtes Kapital 2009/III**). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Einlösung von Bezugsrechten, die auf der Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 6. Mai 2009 bis zum 5. Mai 2014 an Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Geschäftsführung und Mitarbeiter verbundener Unternehmen gewährt werden (Aktienoptionsplan 2009). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie im Rahmen des Aktienoptionsplans 2009 nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 6. Mai 2009 aus dem bedingten Kapital Bezugsrechte ausgegeben werden und die Inhaber dieser Bezugsrechte hiervon innerhalb der Ausübungsfrist Gebrauch machen, soweit nicht ein Barausgleich gewährt wird oder eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie durch Ausübung von Bezugsrechten entstehen, am Gewinn teil.

Die Gesellschaft ist ermächtigt, bis zum 5. November 2010 eigene Aktien zu erwerben. Die Ermächtigung ist auf den Erwerb von Aktien, auf die ein Anteil am Grundkapital in Höhe von bis zu insgesamt 10% des derzeitigen Grundkapitals entfällt, beschränkt. Die Ermächtigung kann ganz oder in mehreren Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, für einen oder mehrere Zwecke im Rahmen der vorgenannten Beschränkung ausgeübt werden.

## WESENTLICHE VEREINBARUNGEN, DIE UNTER DER BEDINGUNG EINES KONTROLLWECHSELS IN FOLGE EINES ÜBERNAHMEANGEBOTS STEHEN

Wesentliche Vereinbarungen für den Fall eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots existieren nicht.

## ENTSCHÄDIGUNGSVEREINBARUNGEN

Die Vorstandsmitglieder sind im Falle eines Kontrollwechsels jeweils berechtigt, ihren Dienstvertrag innerhalb von drei Monaten nach Eintritt des Kontrollwechsels mit einer Frist von sechs Monaten zum Monatsende zu kündigen und ihre Ämter zum Zeitpunkt der Beendigung ihres Dienstvertrages niederzulegen. Für den Fall der Ausübung dieses Kündigungsrechts steht den Vorstandsmitgliedern jeweils eine Abfindung in Höhe von zwei Jahresvergütungen, höchstens aber in Höhe der für die Restlaufzeit ihres Dienstvertrages noch zu zahlenden Vergütung zu. Maßgeblich ist die während des letzten Geschäftsjahres vor Eintritt des Kontrollwechsels gezahlte Vergütung.

## *Erklärung zur Unternehmensführung*

Die Erklärung zur Unternehmensführung ist durch den durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz neu geschaffenen §289a HGB von ELMOS als börsennotierter Aktiengesellschaft abzugeben. Sie wurde abgegeben und ist auf der Internetseite der Gesellschaft dauerhaft öffentlich zugänglich gemacht.

## *Vergütungsbericht*

Die Gesamtvergütung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder besteht aus einer Reihe von Vergütungsbestandteilen.

### GESAMTBEZÜGE DES VORSTANDS

Das Aufsichtsratsplenum beschließt das Vergütungssystem und die wesentlichen Vertrags Elemente für den Vorstand und überprüft sie regelmäßig. Die Gesamtvergütung des Vorstands umfasst ein fixes Monatsgehalt, eine Tantieme, Aktienoptionen sowie Nebenleistungen und Pensionszusagen. Auf eine individualisierte Veröffentlichung der Vergütung wird zur Wahrung der Privatsphäre verzichtet. Eine solche Offenlegung trägt nach Einschätzung von Vorstand und Aufsichtsrat nicht zu einer erweiterten Transparenz in Form von zusätzlichen kapitalmarktrelevanten Informationen bei. Aus diesem Grund hat die Hauptversammlung am 19. Mai 2006 beschlossen, die Gesellschaft für einen Zeitraum von fünf Jahren von der Rechtspflicht zur individualisierten Offenlegung der Vorstandsvergütungen zu befreien.

Im Geschäftsjahr 2009 beliefen sich die fixen Bezüge der Mitglieder des Vorstands auf 1.141 Tsd. Euro (2008: 1.244 Tsd. Euro) und die variablen Bezüge auf 658 Tsd. Euro (2008: 525 Tsd. Euro). Die Bezüge des Vorstands teilen sich in fixe Bezüge und variable, erfolgsorientierte Bezüge auf, die sich auf Ergebnisgrößen und weitere Schlüsselgrößen der Geschäftsführung des ELMOS-Konzerns beziehen. Im Jahr 2009 wurden insgesamt 99.000 Aktienoptionen der ELMOS Semiconductor AG an die Mitglieder des Vorstands ausgegeben. Der Zeitwert dieser Optionen betrug zum Übertragungszeitpunkt 69 Tsd. Euro. Für Mitglieder des Vorstands der ELMOS Semiconductor AG bestehen mittelbare Pensionszusagen, für die aufgrund des Umfangs der Zusage und der vollständig kongruenten Rückdeckung durch eine Rückdeckungsversicherung keine Pensionsrückstellung zu bilden sind. Im Jahr 2009 beliefen sich die Beiträge für diese Pensionspläne auf 347 Tsd. Euro (2008: 366 Tsd. Euro). Diese sind in den fixen Bezügen enthalten.

Die Bezüge für frühere Vorstandsmitglieder bzw. ihre Hinterbliebenen lagen im Geschäftsjahr 2009 bei 283 Tsd. Euro (2008: 255 Tsd. Euro). Ferner wurden für diese Versicherungsprämien in Höhe von 300 Tsd. Euro (2008: 275 Tsd. Euro) entrichtet.

Die Pensionsrückstellung zum 31. Dezember 2009 betrug 2.557 Tsd. Euro (2008: 2.505 Tsd. Euro). Abgesehen von Pensionen sind für den Fall der Beendigung der Tätigkeit keinem Vorstandsmitglied weitere Leistungen zugesagt worden. Ebenso hat kein Mitglied des Vorstands im abgelaufenen Geschäftsjahr Leistungen oder entsprechende Zusagen von einem Dritten im Hinblick auf seine Tätigkeit als Vorstandsmitglied erhalten.

## GESAMTBEZÜGE DES AUFSICHTSRATS

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in §9 der Satzung festgelegt. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben der Erstattung ihrer Auslagen eine feste und eine erfolgsorientierte Vergütung. Die erfolgsorientierte Vergütung ist an die Dividende gebunden und damit auf den langfristigen Unternehmenserfolg ausgerichtet. Der Aufsichtsrat erhält weder Aktien noch Aktienoptionen der ELMOS Semiconductor AG.

Entsprechend der Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex hinsichtlich der Berücksichtigung des Vorsitzes und stellvertretenden Vorsitzes bei der Vergütung erhält der Vorsitzende das Doppelte und sein Stellvertreter das Eineinhalbfache der festen Vergütung. Der Vorsitz und die Mitgliedschaft in Aufsichtsratsausschüssen werden nicht gesondert vergütet. Dies ist als Abweichung in der Entsprechenserklärung aufgeführt. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird summiert, jedoch nicht individualisiert ausgewiesen. Dies gilt auch für an Mitglieder des Aufsichtsrats gezahlte Vergütungen für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere für Beratungs- und Vermittlungsleistungen.

Die feste Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats betrug im Geschäftsjahr 2009 in der Summe 84 Tsd. Euro (2008: 82 Tsd. Euro). Spesen und Auslagen sind darin enthalten. Da in 2009 keine Dividende an die Aktionäre ausgezahlt wurde, ist an die Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2009 keine variable Vergütung gezahlt worden. Für Beratungen, Erfindervergütungen und sonstige Dienstleistungen vergütete die Gesellschaft an Mitglieder des Aufsichtsrats 230 Tsd. Euro (2008: 342 Tsd. Euro).

## *Risiken und Chancen*

### RISIKOMANAGEMENTSYSTEM

zugleich erläuternder Bericht zum internen Kontroll- und Risikomanagementsystem gemäß § 289 Abs. 5 HGB

Die ELMOS Semiconductor AG fasst die innerhalb des Unternehmens vorhandenen Maßnahmen zur Risikosteuerung in einem ganzheitlichen Risikomanagementsystem zusammen. Die Risikopolitik ist darauf ausgerichtet, den Bestand des Unternehmens zu sichern und den Unternehmenswert systematisch und kontinuierlich zu steigern. Das System entspricht den gesetzlichen Anforderungen an ein Risikofrüherkennungssystem und steht im Einklang mit den Deutschen Corporate Governance Grundsätzen.

Mithilfe des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems werden Risiken und Chancen regelmäßig identifiziert und deren Einfluss auf die operativen und finanziellen Unternehmensziele analysiert. Wo der Konzern Kernkompetenzen besitzt, geht er bewusst überschaubare und beherrschbare Risiken ein, wenn gleichzeitig ein angemessener Ertrag zu erwarten ist. Darüber hinaus werden Risiken möglichst vermieden. Insgesamt ist sichergestellt, dass der Konzern die eingegangenen Risiken vollständig abdecken kann.

Es sind verbindliche Vorgaben und Spielregeln zur Risikoerfassung und -steuerung formuliert. Spekulationsgeschäfte oder sonstige Maßnahmen mit spekulativem Charakter sind grundsätzlich verboten. Ob diese Grundsätze eingehalten werden, wird regelmäßig kontrolliert. Zudem tragen zahlreiche und wiederholte Schulungen dazu bei, dass sich alle Mitarbeiter immer der Regeln bewusst sind.

Unmittelbar verantwortlich für die Früherkennung und Steuerung von Risiken sind die jeweiligen operativen Vorgesetzten. Die nächsthöheren Führungsebenen stellen die Kontrolle der Risiken sicher. Der Vorstand trägt die Gesamtverantwortung für das interne Kontroll- und Risikomanagementsystem im Konzern. In einem eingespielten Top-down-Prozess informieren die Bereiche in Risikoinventuren mit abgestuften Schwellenwerten über den aktuellen Status von bedeutenden Risiken. Dabei werden die Risiken nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe bewertet und klassifiziert. Zu jedem Risiko werden Maßnahmen zur Reduzierung aufgeführt; die Frühwarnindikatoren werden regelmäßig aktualisiert und mit den Verantwortlichen erörtert. Regelmäßig werden von externen Fachleuten Qualitäts-System-Audits durchgeführt und die Ergebnisse analysiert.

Systematisch und transparent aufbereitet werden die Daten zu den materiellen Konzernrisiken dem Vorstand und Aufsichtsrat der ELMOS Semiconductor AG vorgelegt. Ad-hoc-Risiken und eingetretene Schäden werden bei Eilbedürftigkeit unabhängig von den normalen Berichtswegen unmittelbar kommuniziert. Die kontinuierliche Entwicklung der Instrumente und Methoden zur Risikoerfassung und -steuerung ist ein laufender Prozess, der ununterbrochen nach Fehlerquellen untersucht wird.

Das interne Kontrollsystem besteht aus einer Reihe von Strukturen und Prozessen zur Risikokontrolle mit dem Ziel, Risiken zu erkennen sowie bekannte Risiken zu begrenzen und diese im Konzernabschluss abzubilden. Es umfasst die vom Management eingeführten Grundsätze, Verfahren und Maßnahmen, die auf die organisatorische Umsetzung der Entscheidungen des Managements gerichtet sind, um die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftstätigkeit, die Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der internen und externen Rechnungslegung sowie die Einhaltung der maßgeblichen rechtlichen Vorschriften sicherzustellen. Sie werden in regelmäßigen Abständen an aktuelle interne und externe Entwicklungen angepasst.

Im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess der einbezogenen Unternehmen und des Konzerns sind Strukturen und Prozesse implementiert, die die Ordnungsmäßigkeit des Konzernabschlusses sicherstellen. Der Vorstand trägt die Gesamtverantwortung für das interne Kontroll- und Risikomanagementsystem, auch im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess. Über eine fest definierte Führungs- und Berichtsorganisation sind alle in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften und Konzerneinheiten eingebunden. Die Grundsätze, Aufbau- und Ablauforganisation sowie die Prozesse des rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll- und Risikomanagementsystems sind konzernweit durch entsprechende Richtlinien und Arbeitsanweisungen geregelt, die bei Bedarf an aktuelle interne und externe Entwicklungen angepasst werden. Wesentliche Merkmale des auf den Rechnungslegungsprozess bezogenen internen Kontroll- und Risikomanagementsystems sind (i) die Identifikation der wesentlichen Risikofelder und Kontrollbereiche mit Relevanz für den konzernweiten Rechnungslegungsprozess, (ii) Kontrollen zur Überwachung des Rechnungslegungsprozesses und dessen Ergebnisse, (iii) präventive Kontrollmaßnahmen im Finanz- und Rechnungswesen und den Bereichen, die wesentliche Informationen für die Aufstellung des Konzernabschlusses generieren, inklusive definierter Genehmigungsprozesse in relevanten Bereichen sowie (iv) Maßnahmen zur ordnungsgemäßen EDV-gestützten Verarbeitung von konzernrechnungslegungsbezogenen Sachverhalten und Daten.

Wesentliche Elemente zur Risikosteuerung und Kontrolle in der Rechnungslegung sind die klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten und Kontrollen bei der Abschlusserstellung, transparente Vorgaben mittels Richtlinien zur Bilanzierung und Abschlusserstellung, angemessene Zugriffsregelungen in den abschlussrelevanten EDV-Systemen sowie die eindeutige Regelung von Verantwortlichkeiten bei der Einbeziehung externer Spezialisten. Das Vier-Augen-Prinzip und die Funktionstrennung sind auch im Rechnungslegungsprozess wichtige Kontrollprinzipien.

Resümierend ist festzuhalten, dass sich das vom Vorstand der ELMOS Semiconductor AG eingeführte Risikomanagement- und interne Kontrollsystem, insbesondere auch bezogen auf den Rechnungslegungsprozess, als effizient bewährt hat.

## RISIKEN

### ABHÄNGIGKEIT VON DER AUTOMOBILINDUSTRIE

Das Kerngeschäft von ELMOS steht in direktem Zusammenhang mit der Nachfrage der Automobilindustrie nach Halbleitern. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2009 wurden rund 85% des Umsatzes mit Chips für die Automobilelektronik erwirtschaftet. Diese Nachfrage ist einerseits abhängig von den produzierten Stückzahlen an Fahrzeugen und wird andererseits von dem anhaltenden Trend zu mehr Elektronik im Auto gesteuert. Ein starker Einbruch bei den Automobil-Produktions- und Absatzzahlen – wie er in zahlreichen Ländern in 2009 zu verzeichnen war – stellt auch für ELMOS als Halbleiterlieferanten ein Risiko dar. Dieser Entwicklung steuert ELMOS mit entsprechenden Kostensenkungsmaßnahmen entgegen; jedoch dürfte ein anhaltender Nachfragerückgang aus der Automobilindustrie signifikante Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben.

Der Automobilmarkt unterlag in der Vergangenheit als Folge von Zusammenschlüssen von Systemherstellern, restriktiver Umweltgesetzgebung und anderen Faktoren beachtlichen Schwankungen. Die Kundenstruktur deutet auf eine gewisse Abhängigkeit von einigen großen Automobilzulieferern hin. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass ein Kunde in der Regel mehrere Produkte mit verschiedenen Lebenszyklen bezieht. Aufgrund der Tatsache, dass ASICs kundenspezifische Produkte sind, ergibt sich eine besondere gegenseitige Abhängigkeit zwischen Lieferant und Kunde. Abweichend davon kann es bei großen Stückzahlen der Fall sein, dass ein Kunde einen ASIC bei zwei Lieferanten entwickeln lässt. Durch die verstärkte Hinwendung von ELMOS zu anwendungsspezifischen Standardprodukten (ASSPs) wird diese Kundenabhängigkeit verringert, da solche Produkte an mehrere Kunden verkauft werden können.

### WETTBEWERB

Eine Vielzahl von Wettbewerbern im Halbleitermarkt für automobiler Anwendungen bietet ähnliche Produkte wie ELMOS auf vergleichbarer technologischer Grundlage an. Darüber hinaus ist nicht auszuschließen, dass große Halbleiterhersteller, die bisher noch gar nicht oder nur zu einem geringen Prozentsatz im automobilen Halbleitermarkt tätig sind, in Zukunft versuchen werden, in dieses Marktsegment einzudringen. Die Wahrscheinlichkeit für deren Engagement in einem solchen Nischenmarkt ist jedoch relativ gering und somit auch das für ELMOS damit verbundene Risiko. Bei großvolumigen Aufträgen steht ELMOS allerdings mehr im Wettbewerb auch zu Großproduzenten und spürt entsprechenden Preisdruck. Zudem besteht für ELMOS das Risiko, dass Kunden auf Wettbewerber zurückgreifen, wenn Parallelentwicklungen durchgeführt werden.

### ABHÄNGIGKEIT VON EINZELNEN MITARBEITERN

Die sehr entwicklungsintensive Geschäftstätigkeit des Unternehmens führt zu einem stark ausgeprägten und sehr spezifischen Ingenieur-Know-how – jedoch nur teilweise zu Patenten. Somit ergibt sich für ELMOS, wie für jedes Technologieunternehmen, eine erhöhte Abhängigkeit von bestimmten Mitarbeitern.

### ENTWICKLUNG NEUER PRODUKTE UND TECHNOLOGIEN

Der Markt für die ELMOS-Produkte ist durch ständige Weiterentwicklung und Verbesserung der Produkte gekennzeichnet. Der Erfolg von ELMOS ist deshalb stark von der Fähigkeit abhängig, neue komplexe Produkte preisgünstig zu entwickeln, sie rechtzeitig im Markt einzuführen und zu erreichen, dass diese Produkte von Zulieferern der Automobilindustrie ausgewählt werden.

Durch die Fähigkeit von ELMOS, Produkte für alle Arten von elektronischen Geräten im Automobil zu entwickeln und zu fertigen, sind ELMOS-Produkte in zahlreichen elektronischen Komponenten eines PKWs vertreten, so dass das Risiko des Wegfalls eines Auftrages für eine einzelne elektronische Komponente breit gestreut ist.

Bei der kundenspezifischen Entwicklung von Produkten werden in der Regel die Einmalkosten im Entwicklungsbereich nicht mehr in vollem Umfang von den Kunden bezahlt. Diese vorab nicht gedeckten Entwicklungskosten müssen über die späteren Stückzahlen in der Serie amortisiert werden. Bei Entwicklungen, die nicht in eine Lieferbeziehung münden, besteht das Risiko, dass nicht amortisierte Kosten bei der Gesellschaft verbleiben. Gerade bei den hochvolumigen Aufträgen, um die sich eine größere Anzahl von Wettbewerbern bemüht, ist der Kunde in der Regel nicht bereit, die Entwicklungskosten vorab zu übernehmen, sondern erwartet, dass diese vom Lieferanten vorfinanziert werden. Für von ELMOS selbst initiierte Produktentwicklungen, wie beispielsweise alle ASSPs, ist dies in der Regel der Fall, da hierfür keine festen Kundenaufträge vorliegen.

Der zukünftige Erfolg von ELMOS ist auch von der Fähigkeit abhängig, neue Entwicklungs- und Produktionstechnologien zu entwickeln. ELMOS entwickelt analoge und digitale Halbleiterstrukturen und -funktionen für ihre selbst entwickelte modulare Hochvolt-CMOS-Prozesstechnologie. Wie alle Wettbewerber muss auch ELMOS ihre Technologie ständig verbessern und neue Prozesstechnologien für die fortschreitende Verkleinerung der Strukturen im Submikronbereich entwickeln. Sollte ELMOS zukünftig nicht in der Lage sein, neue Produkte und Produktverbesserungen zu entwickeln, zu produzieren und abzusetzen, dürfte dies signifikante Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben.

#### BESCHAFFUNG

Die von ELMOS für die Fertigung benötigten Rohstoffe sind weltweit bei verschiedenen Lieferanten verfügbar und unterliegen weitestgehend keinen Monopolanbietern. Branchentypisch ist eine gewisse Abhängigkeit von einzelnen fernöstlichen Partnern im Assembly-Bereich. ELMOS hat das Risiko gestreut, indem mit mehreren Partnern zusammengearbeitet wird.

#### PRODUKTHAFTUNG

Die von ELMOS produzierten Produkte werden als Komponenten in komplexe elektronische Systeme integriert. Fehler oder Funktionsmängel der von ELMOS hergestellten Halbleiter oder der elektronischen Systeme, in die sie integriert sind, können direkt oder indirekt Eigentum, Gesundheit oder Leben Dritter beeinträchtigen. ELMOS ist nicht in der Lage, ihre Haftung gegenüber Abnehmern oder Dritten in ihren Absatzverträgen zu reduzieren oder auszuschließen.

ELMOS verfolgt konsequent eine Null-Fehler-Strategie und investiert stetig in die Erkennung und Vermeidung von Fehlerquellen und Fehlern. So werden die einzelnen Halbleiterchips hinsichtlich ihrer Qualität und Funktion in der Produktion im Regelfall mehrfach bei unterschiedlichen Temperaturen getestet. Obwohl die Gesellschaft weitreichende Testverfahren vor der Auslieferung ihrer Produkte einsetzt, können sich Produktfehler möglicherweise erst beim Verbau oder dem Gebrauch der Produkte durch den Endverbraucher zeigen.

Wenn solche Produktfehler auftreten, kann dies teure und zeitaufwendige Produktmodifikationen nach sich ziehen und zu Beeinträchtigungen in den Kundenbeziehungen sowie zum Verlust von Marktanteilen führen. Ein Qualitätsproblem ganzer Chargen könnte zudem zu Regressansprüchen der Kunden im Millionenbereich führen. Dieses Risiko ist angemessen versichert. Dennoch können diese Risiken negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben.

#### BETEILIGUNGSBEREICH

Durch die hohe Allokation von finanziellen Mitteln in die Tochtergesellschaften besteht die erhöhte Pflicht, mit entsprechenden Controlling-Instrumenten und kontinuierlichen Soll-Ist-Analysen mögliche Risiken frühzeitig zu erkennen bzw. zu minimieren. Hierfür wird das installierte Risikomanagement und interne Kontrollsystem laufend erweitert und verbessert. Dennoch können diese Risiken negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben.

## INFORMATIONSTECHNISCHE RISIKEN

Wie für andere globale Unternehmen sind auch für uns die Zuverlässigkeit und Sicherheit der IT von großer Bedeutung. Dies gilt in zunehmendem Maße sowohl für den Einsatz informationstechnischer Systeme zur Unterstützung unserer Geschäftsprozesse, als auch für die Unterstützung der internen und externen Kommunikation. Trotz aller technischen Vorsichtsmaßnahmen kann jede gravierende Störung dieser Systeme zu einem Datenverlust und/oder zu einer Beeinträchtigung der Produktion oder Störung von Geschäftsprozessen führen.

Deshalb sind alle kritischen IT-Systeme auf Infrastruktur hoher Verfügbarkeit untergebracht. Diese mit Redundanzen in verschiedenen Datenzentren ausgestatteten Systeme minimieren bzw. eliminieren die Konsequenzen von Hardware-Störungen. Eine ständige automatisierte Überwachung der IT-Infrastruktur ermöglicht uns ein rasches Eingreifen im Falle von unvorhersehbaren Störfällen.

Besondere Vorkehrungen wurden zudem zur Abwehr von Virusangriffen getroffen. So wird beispielsweise der Internetzugriff besonders aufwändig abgesichert. Zusätzliche Maßnahmen werden für Systeme umgesetzt, die in den Fertigungen verwendet werden.

## BETRIEBSUNTERBRECHUNG

Neben den bereits dargestellten und erläuterten Geschäftsrisiken ist nach Einschätzung von ELMOS das einzige wesentliche betriebliche Risiko, das die Entwicklung des Konzerns beeinträchtigen und den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnte, das Risiko der Zerstörung der Fertigungsanlagen durch Feuer oder andere Katastrophen. Zwar ist das Betriebsunterbrechungsrisiko durch solche Ereignisse angemessen versichert, jedoch bestünde in einem solchen Fall eine erhebliche Gefahr des Verlustes von Schlüsselkunden. Dieses Risiko ist nicht versicherbar.

Dieses Risiko ist dadurch reduziert, dass eine zweite Fertigungslinie für Halbleiter am Standort Duisburg betrieben wird – parallel zur Fertigung am Standort Dortmund. Damit verfügt ELMOS über voneinander unabhängige Fertigungslinien, die autark produzieren können. Unabhängig davon könnte eine Betriebsunterbrechung an einem der Produktionsstandorte negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben.

Die üblichen versicherbaren Risiken wie Feuer, Feuerbetriebsunterbrechung, Wasser, Sturm, Diebstahl, Haftpflicht, insbesondere Produkthaftpflicht, auch in den USA, sowie die Kosten eines etwaigen Rückrufs, sind angemessen versichert. Weitere Risiken, die die Entwicklung des Konzerns wesentlich beeinträchtigen oder den Fortbestand des Konzerns gefährden können, sind derzeit nicht erkennbar.

## CHANCEN

Neben unserem Kerngeschäft der kundenspezifischen Halbleiter in der Automobilindustrie bieten sich durch die weitere Strategieumsetzung Chancen für die Gesellschaft. Diese liegen in der vermehrten Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von applikationsspezifischen Halbleitern (ASSPs) sowie in einem zukünftig höheren Anteil unseres Umsatzes in den Bereichen Industrie und Konsumgüter, was implizit auch eine verminderte Abhängigkeit von der Automobilindustrie zur Folge hat. Zudem planen wir, unser Geschäft in den asiatischen Märkten auszuweiten und mit Partnern zu kooperieren, die uns entweder ermöglichen, unser Produktportfolio zu erweitern, oder Möglichkeiten zur Fremdfertigung bieten. Des Weiteren soll der Anteil an Mikrosystem-Projekten, der Zusammenführung von Sensoren und Auswerteelektronik in einem applikationsspezifischen Gehäuse, steigen.

## *Nachtragsbericht*

Die EFH ELMOS Finanzholding GmbH war zum 31. Dezember 2009 mit rund 52,9% am Grundkapital der Gesellschaft beteiligt. Die Gesellschafter der EFH ELMOS Finanzholding GmbH, die Dr. Weyer GmbH & Co. Vermögensverwaltung KG, die ZOE GmbH & Co. KG und die Jumakos GmbH & Co. KG, haben im Dezember 2009 eine Umstrukturierung der EFH ELMOS Finanzholding GmbH im Wege einer Aufspaltung nach dem Umwandlungsgesetz beschlossen, als deren Folge die EFH ELMOS Finanzholding GmbH am 26. Januar 2010 erloschen ist. Die vormals von der EFH ELMOS Finanzholding GmbH unmittelbar und (über ihre 100%-igen Tochtergesellschaften Dr. Weyer GmbH, ZOE-BTG GmbH und Makos GmbH) mittelbar gehaltenen Aktien der Gesellschaft sind im Zuge dieser Aufspaltung jeweils auf Gesellschaften übergegangen, die ihrerseits von der Dr. Weyer GmbH & Co. Vermögensverwaltung KG, der ZOE GmbH & Co. KG und der Jumakos GmbH & Co. KG kontrolliert werden. Nach Wirksamwerden der Aufspaltung der EFH ELMOS Finanzholding GmbH am 26. Januar 2010 verteilen sich die vormals von der EFH ELMOS Finanzholding GmbH unmittelbar und mittelbar gehaltenen Aktien der Gesellschaft damit wie folgt auf die Gesellschafter der (erloschenen) EFH ELMOS Finanzholding GmbH:

- > Dr. Weyer GmbH & Co. Vermögensverwaltung KG: 20,5%,
- > Jumakos GmbH & Co. KG: 16,7%,
- > ZOE GmbH & Co. KG: 15,7%.

Die vorstehend genannten Stimmrechtsanteile werden von den Gesellschaften jeweils mittelbar gehalten.

Darüber hinaus sind keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten.

## *Prognosebericht*

### **WIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN**

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind insgesamt zufriedenstellend. Die Wachstumsaussichten sind gut bis sehr gut, wenngleich volatil. Zu berücksichtigen ist, dass die Ausgangsbasis krisenbedingt niedrig ist. Während für den weltweiten Automobilmarkt ein geringeres Wachstum vorhergesagt wird, soll der automobiler Halbleitermarkt wieder deutlich wachsen. Ähnlich sieht es für die Produktion der deutschen Elektroindustrie aus, hier wird ein schwaches Wachstum erwartet. Der weltweite Halbleitermarkt soll 2010 hohe Zuwachsraten generieren. Im Einzelnen stellen sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen folgendermaßen dar.

Für 2010 rechnet der VDA für Deutschland nach dem außergewöhnlichen Zulassungsjahr 2009 mit Sonderfaktoren wie der Abwrackprämie mit einem deutlichen Rückgang bei dem inländischen Automobilabsatz. Der inländische Pkw-Markt soll demnach 2010 auf 2,75 bis 3,0 Mio. Neuzulassungen nachgeben. Der VDA sieht darin aber nur einen Rückgang auf das deutsche Normalmaß bzw. auf einen Wert nur wenig unter dem langjährigen Durchschnitt des deutschen Automarkts. Weltweit ist mit einer leichten Erholung zu rechnen. Der chinesische Markt soll wiederum deutlich wachsen, um mindestens 10% gegenüber 2009. Für die USA rechnet der VDA ebenfalls mit einem Zuwachs um 10% gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt soll die weltweite Automobilproduktion in 2010 rund 55 Millionen Fahrzeuge umfassen (2009: 53 Mio. Fahrzeuge).

Für den Nischenmarkt der automobiler Halbleiter prognostiziert das Marktforschungsunternehmen Semicast für 2010 ein Wachstum von 16% gegenüber 2009.

Die Produktion der deutschen Elektroindustrie wird 2010 voraussichtlich um 3% bis 4% steigen. Im Krisenjahr 2009 ist sie um 22% zurückgegangen, so der ZVEI. Der Umsatz werde von zuletzt 145 Mrd. Euro auf 150 Mrd. Euro ansteigen.

Für den weltweiten Halbleitermarkt 2010 gibt es nur Marktforschungsunternehmen, welche ein Wachstum im zweistelligen Bereich prognostizieren. Das Marktforschungsunternehmen World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) markiert mit einem Umsatzplus von 12,2% für 2010 die untere Grenze. Future Horizons wiederum liegt mit seinem prognostizierten Wachstum von 22% am oberen Limit. Durchschnittlich wird ein Anstieg um 15% erwartet (Quelle: Natixis Securities).

### **AUSBlick DER ELMOS SEMICONDUCTOR AG**

ELMOS hat ihre Strategie auch in Zeiten der weltweiten Krise vorangetrieben und konsequent weitergeführt. Insbesondere vor dem Hintergrund des Umsatzrückganges in 2009 stand dabei der Erhalt einer starken finanziellen

Basis und die Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen im Fokus des Managements. Sogar in der äußerst schwierigen Marktsituation des vergangenen Jahres wurden die mit den strategischen Wachstumsfeldern verbundenen Chancen für die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft wahrgenommen. Daher wird ELMOS folgerichtig die Strategie in 2010 und den kommenden Jahren weiterführen.

Die strategischen Eckpfeiler lauten im Einzelnen:

- > Vermehrte Definition, Entwicklung und Vertrieb von ASSPs
- > Intensivierung der Aktivitäten in Industrie- und Konsumgütermärkten
- > Ausweitung des Engagements in den asiatischen Märkten
- > Verstärkte Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern zur Optimierung des Produktportfolios und Reduktion der Investitionen
- > Steigerung des Umsatzanteils von Mikrosystemen

Zudem werden die Flexibilität und Wettbewerbsfähigkeit der Produktion weiter erhöht. So wird beispielsweise seit dem dritten Quartal 2009 – nachdem die krisenbedingte starke Zurückhaltung bei Investitionen gelockert wurde – auch wieder die Modernisierung der Fertigung am Hauptsitz in Dortmund vorangetrieben.

Das Hauptrisiko für das Jahr 2010 ist eine erneute Abschwächung des weltweiten Automobilabsatzes. Dies hätte wahrscheinlich eine geringere Nachfrage nach unseren Halbleiterchips zur Folge und dementsprechend ein niedrigeres Auftragsniveau. Aufgrund der Erfahrungen von Ende 2008 und 2009 richtet das Management besonderes Augenmerk auf erste Warnsignale, die zu solch einem möglichen Szenario führen könnten. Falls solch ein Hinweis offensichtlich würde, sind weitere Optionen für zusätzliche Kosteneinsparungen gegeben und können nach Bedarf und Marktverfassung kurzfristig implementiert werden.

Das Unternehmen ist ebenso für einen schnellen Aufschwung aufgestellt. Auch für dieses Szenario hat das Management basierend auf den Erfahrungen der vergangenen Monate entsprechende Maßnahmen für eine erfolgreiche Umsetzung und termingerechte Lieferung unserer Produkte an Kunden etabliert.

Basierend auf der Erfahrung der vergangenen Monate mit hoher Volatilität sind wir für 2010 verhalten positiv gestimmt. Zum Ende des Jahres 2009 lag das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz (Book-to-Bill) bei über eins. Aufgrund des guten Starts in das Jahr 2010 gehen wir für das Gesamtjahr 2010 von einem Umsatzwachstum aus. Genaueres kann derzeit aufgrund der Unsicherheiten der Gesamtwirtschaftslage und der daraus resultierenden mangelnden Visibilität für das zweite Halbjahr 2010 nicht gesagt werden.

Dortmund, im März 2010

## **Der Vorstand**

**Dr. Anton Mindl**

**Nicolaus Graf von Luckner**

**Reinhard Senf**

**Jürgen Höllisch**